# С помощью ініст в Містоначе Фильтров Проектирование Фильтров



2010 г.

# Оглавление

Оглавление	1
1. Интерфейс пользователя	2
1.1. Туре – Approximation (Тип – Аппроксимация)	2
1.1.1. Выбор типа фильтра	2
1.1.2. Выбор типа характеристики	3
1.2. Specifications (Технические требования).	4
1.3. Parasitics (Паразитные элементы).	4
1.4. Design Control (Управление пректом).	4
1.4.1. Design Options (Опции проекта)	4
1.4.2. Design Utilities (Утилиты проекта).	7
1.4.3. Environment Options (Опции среды).	9
1.4.4. Generate Design (Генерировать проект)	9
1.5. Редактирование свойств графика.	10
1.6. Отображение результатов синтеза	12
2. Примеры синтеза	13
2.1. Синтез фильтров на сосредоточенных элементах	13
2.1.1. Полосно-пропускающий фильтр.	13
2.1.2. Фильтр нижних частот	17
2.2. Синтез микрополосковых фильтров	18
2.2.1. Фильтр нижних частот с частотой среза 2 ГГц.	18
2.2.2. Фильтр нижних частот с частотой среза 10 ГГц.	22
2.2.3. Полосно-пропускающий фильтр с боковыми связями 3 – 3.1 ГГц.	25
2.2.4. Полосно-пропускающий фильтр со ступенчатыми резонаторами 1.9-2.1 ГГц	30
2.2.5. Полосно-пропускающий шпилечный фильтр 4 – 4.5 ГГц.	35
2.2.6. Полосно-пропускающий встречноштыревой фильтр 11 – 14.5 ГГц.	39
2.2.6. Полосно-пропускающий фильтр на параллельных шлейфах 4 – 8 ГГц	43
2.2.7. Полосно-заграждающий фильтр на параллельных шлейфах	46
2.2.8. Полосно-пропускающий фильтр с боковыми связями 14 – 18 ГГц.	48

iFilter – это программа синтеза фильтров, которая выполняется в AWRDE. Синтез фильтров базируется на известном методе использования фильтров-прототипов нижних частот. iFilter позволяет синтезировать фильтры на сосредоточенных и на распределённых элементах. Основное внимание в этом пособии уделено микрополосковым фильтрам. Использовалась AWR v9 04 4969 2.

Е.Е. Дмитриев

# 1. Интерфейс пользователя

iFilter отображается в окне просмотра проекта в группе Wizards, если она установлена и имеется соответствующий файл лицензии.

Чтобы запустить iFilter, paзверните группу Wizards и дважды щёлкните по iFilter Filter Wizard. Или щёлкните правой кнопкой по iFilter Filter Wizard и выберите RUN. Откроется основное окно программы рис. 1.1.



Рис. 1.1

В этом окне имеется несколько областей, описанных далее.

При загрузке программы в основном окне отображаются данные, которые в нём были установлены при выполнении предыдущего синтеза фильтра в этой программе.

# 1.1. Туре – Approximation (Тип – Аппроксимация).

В этой области находятся опции для выбора типа фильтра (на сосредоточенных или распределённых элементах), типа характеристики и установки пульсаций в полосе пропускания.

### 1.1.1. Выбор типа фильтра.

Для выбора типа фильтра щёлкните по верхней кнопке в области **Type – Approximation**. На рис. 1.1 это кнопка **Lumped Element**. Имя кнопки зависит от выбранного типа фильтра. Щелчок по этой кнопке открывает окно **Select Filter Type** рис. 1.2.

В верхней части этого окна расположена панель **Passband**, которая содержит следующие кнопки, определяющие тип синтезируемого фильтра:

**Lowpass** – фильтр нижних частот.

Select Filter Type       Image: Constraint of the second of	<ul> <li>Нighpass – фильтр верхних частот.</li> <li>Bandpass – полосно-пропускающий фильтр.</li> <li>Bandstop – полосно-заграждающий фильтр. Ниже расположена панель Realiztion, кнопки на которой определяют способ реализации фильтра:</li> <li>Lumped – фильтр на сосредоточенных элементах.</li> <li>Microstrip – фильтр на микрополосковой линии.</li> </ul>
	<b>Stripline</b> – фильтр на симметричной полос- ковой линии.
Design dual circuit (input: series/shunt)	<b>EEE</b> Rect. Bars – фильтр на прямоугольных
Compare OK Cancel	стержнях. <b>Round Rods</b> – фильтр на круглых стержнях.

#### Рис. 1.2

Ниже указанных панелей находятся два

окна со списками. Левое окно Main Filter Туре содержит список возможных вариантов реализации фильтра в зависимости от выбранного типа фильтра и способа реализации.

Правое окно **Options** содержит список некоторых уточнений к выбранному варианту реализации, например, тип связи и др.

Если отметить Design dual circuit (input: series/shunt), будет синтезироваться фильтр, дуальный к выбранным установкам. Эта опция работает в том случае, если дуальный тип фильтра возможен. Например, если выбрано Lowpass и Lumped и отмечено Design dual circuit (input: series/shunt), то схема фильтра будет начинаться с параллельной ёмкости, а не с последовательной индуктивности, если сопротивления источника и нагрузки равны. Если эти сопротивления определены иначе, возможный вариант схемы будет выбран автоматически, независимо от установки данного флажка.

### 1.1.2. Выбор типа характеристики.

Для выбора типа характеристики щёлкните по второй кнопке сверху в области Туре -

Approximation Function	m 🔼	<u> </u>			
Chebyshev     Maximally Flat     Bessel     Lin.Phase 0.05dB     Lin.Phase 0.5dB					
Gaussian Trans.Gauss 6-dB Trans.Gauss 12-dB		Chang	je Passbano	d Ripple	X
Legendre		VSWR Passt Retur VSW Ref C Min 2	2 and ripple (dB) m loss (dB) R Coeff, rho Zload	0.01 26.382 1.1007 0.047 45.423	
ОК	Cancel Apply	Max :	ZLoad	55.037 ОК Отмена	Применить
Рис. 1	.3		]	Рис. 1.4	

Approximation. На рис. 1.1 это кнопка Chebyshev. Имя кнопки зависит от выбранного типа характеристики. Щелчок по этой кнопке открывает окно Арргохіmation Function рис. 1.3.

Доступные типы характеристики зависят от выбранного типа и способа реализации фильтра. Выбрав тип характеристики, нажмите Apply и OK.

В поле ввода **Ripple[dB]** в области Туре – Approximation (см. рис. 1.1) вводится величина пульсаций в полосе пропускания. Нужное значение для пульсаций можно ввести с клавиатуры или щёлкая по кнопкам со стрелками 🕯 🦊 справа от этого поля ввода.

Это поле доступно только для характеристик фильтров, имеющих пульсации в полосе пропускания. Если щёлкнуть по кнопке Ripple[dB], открывается окно рис. 1.4, в котором можно ввести величину пульсаций не только в прямом ослаблении, но и в возвратных потерях, VSWR или в коэффициенте ослабления. Все эти параметры взаимно связаны. При изменении одного из них, изменяются и остальные. Значения Min ZLoad и Max ZLoad только для информации. Они показывают, при каких отклонениях сопротивления нагрузки от 50 Ом значение VSWR сохраняется.

Возможный порядок фильтра (Degree) зависит от выбранного типа фильтра и его реализации. Например, для полосно-пропускающего фильтра с характеристикой Chebyshev порядок фильтра может быть в пределах 1 – 50, если выбран фильтр на сосредоточенных элементах (Lumped), и в пределах 3 – 15, если выбран фильтр на микрополоске с боковыми связями (Edge Coupled Bandpass Filter).

# 1.2. Specifications (Технические требования).

В этой области определяются необходимые исходные параметры для синтезируемого фильтра. В зависимости от выбранного типа фильтра и его реализации список доступных параметров изменяется. В списке могут быть следующие параметры:

Degree – порядок фильтра-прототипа нижних частот.

**Fp** – частота отсечки для фильтров ФНЧ и ФВЧ.

F0 – центральная частота для полосно-пропускающих и полосно-заграждающих фильтров. Границы полосы пропускания определяются как F0-BW/2 и F0+BW/2. Эти границы определяются по заданному уровню пульсаций для Чебышевских фильтров и по уровню 3 дБ для других фильтров.

**BW** – ширина полосы пропускания для полосно-пропускающих фильтров и ширина полосы за-граждения для полосно-заграждающих фильтров.

**RSource** – сопротивление источника.

**RLoad** – сопротивление нагрузки.

Stopb.IL – уровень потерь заграждения для эллиптического фильтра.

Low Z0 – желательное сопротивление для низкоомных отрезков линий в фильтрах ФНЧ.

High Z0 – желательное сопротивление для высокоомных отрезков линий в фильтрах ФНЧ.

Lshunt – желательная параллельная индуктивность в резонаторах полосовых фильтров с емкостной связью резонаторов.

TLIN Z0 – полное сопротивление отрезков линии передачи для фильтров на резонаторах со ступенчатым импедансом (Stepped Impedance Resonator – SIR).

Image Z0 – желательный уровень полного сопротивления фильтров с боковой связью.

Изменять эти параметры можно щёлкая по кнопкам справа, или ввести нужное значение в поле ввода и нажать клавишу Enter, или щёлкнуть мышкой в нужном поле ввода параметра и вращать колёсико мышки.

### 1.3. Parasitics (Паразитные элементы).

В этой области определяются параметры, которые влияют на потери в фильтрах. Здесь доступны только три параметра. Для сосредоточенных элементов это добротности индуктивностей и емкостей (QL и QC), для отрезков линий – потери на единицу длины линии Att[dB/cm]. Дополнительные параметры можно определить в опциях проекта (Design Options) на вкладке Parasitics.

### 1.4. Design Control (Управление пректом).

В этой области устанавливается ряд опций, действующих в проекте и описанных далее.

### 1.4.1. Design Options (Опции проекта).

Здесь устанавливается ряд опций проекта в зависимости от типа и способа реализации фильтра. Обратите внимание, что в левом краю этой кнопки отображается значок, показывающий способ реализации фильтра, на сосредоточенных или распределённых элементах.

### Фильтры на распределённых параметрах.

Если фильтр на распределённых элементах, открывается окно **Distributed Model Options** рис. 1.5, в котором имеется несколько вкладок. Перечисленные на вкладках опции могут быть доступны или не доступны в зависимости от типа синтезируемого фильтра.

Distributed Model Options	X
Realization Technology Parasitics Limits	
General	
Add input and output lines to the layout	
Bend/fold long lines when appropriate	
Split shunt impedances if smaller than Zmin	
Coupled Lines	
Alternate input ports to save diagonal space	
Layout	
Draw a reference box for comparison	
Box width[mm] 100 Set to current	
Box height[mm] 100 bounds	
ОК Отмена Применить	
	-

На вкладке **Realization** имеются следующие опции: В области **General** (Общие):

- Add input and output lines to the layout добавляет отрезки линий на входе и выходе в топологии.
- Bend/fold long lines when appropriate изгибает/свёртывает линии, если возможно.
- Split shunt impedances if smaller than Zmin. Действует для фильтров на шлейфах. Если эта опция отмечена, то шлейфы с сопротивлением, ниже указанного (30 Ом на рис. 1.5), заменяются двумя параллельными шлейфами с большим сопротивлением. Это позволяет избежать слишком широких шлейфов.

В области Coupled Lines (Связанные линии):

Рис. 1.5

• Alternate input ports to save diagonal space. Эта опция влияет на топологию фильтров со сту-

Distributed Model Option	ns 🔀	
Realization Technology Pa	arasitics Limits	
Microstrip	[	
Substrate Er	10.35 °	
Height(H)[mm]	0.5 t .sg	
Cond. Thickness(t)[mm]		
Loss Tangent (tanD)	0.0009	
eq:massessessessessessessessessessessessesse	r order mode) vave mode) eedances 1/4mm 0243mm 4531mm 6137mm	Di F
	ОК Отмена Применить	

Рис. 1.6

Machined Structures

Min Width[mm] 0.5

Min Spacing[mm] 0.2

Distributed Model Options.

Printed Structures

Min Width[mm]

Min Spacing[mm] 0.05

Alumina (50um,50um) Thin Softhoard (75um,

Load Selected Limits

Thick Softboard (100um,100um)

These limits are for warning purposes only

If reached, they will be reported in the information window The filter element values will not be limited.

Realization Technology Parasitics Limits

0.05

пенчатыми резонаторами (Stepped Impedance Resonator Filter). Если она включена, порты располагаются на одной линии, в противно случае – по диагонали. В области Lavout (Топология):

• Draw a reference box for comparison. Если эта опция отмечена, в отображении топологии в нижней правой части основного окна будет показан прямоугольник с введёнными размерами ширины и длины. Размеры прямоугольника выбираются такими, чтобы в нём разместилась топология. Щелчок по кнопке Set to current bounds устанавливает текущие размеры

Distributed Model Options		
Realization Technology Parasitics Limits		
Transmission Line Attenuation		
Att [dB/cm] 0.001		
Ref [MHz] 1 for given Att		

ет текущие размеры прямоугольника. Таким образом можно оценить необходимые размеры корпуса для фильтра. На синтез и анализ этот прямоугольник никак не

Рис. 1.7 угольник влияет и его размеры в МWO не передаются.

На вкладке **Technology** устанавливаются параметры линии передачи. На рис. 1.6 показан пример для микрополосковой линии. Здесь устанавливаются диэлектрическая проницаемость подложки **Substrate Er**, толщина проводника **Cond. Thickness(t)[mm]**, толщина подложки **Height(H)[mm]** и тангенс потерь **Loss Tangent (tanD)**. Щёлкнув мышкой в поле **Substrate Er** и вращая колёсико мышки, вы можете устанавливать значения **Er** для популярных материалов из внутренней базы. Аналогично можно устанавливать и толщину подложки.

В нижней части окна приводится некоторая справочная информация.

На вкладке **Parasitics** (рис. 1.7) вводятся потери в линии **Att [dB/cm]** на заданной частоте **Ref [MHz]**. Частотная зависимость потерь от частоты предполагается линейной.

На вкладке Limits (рис. 1.8) указываются предельные размеры отрезков линий.

Рис. 1.8

OK

Отмена Применить

В области Printed Structures указываются минимальная ширина Min Width[mm] и минимальный зазор Min Spac-

ing[mm] для печатного изготовления плат. При щелчке по кнопке Load Selected Limits эти значения устанавливаются по умолчанию для материала, выбранного в списке ниже.

В области Machined Structures указываются те же значения для обработки на станке.

В нижней части окна отображается поясняющая информация. На рис. 1.8 она поясняет, что эти пределы только для вывода предупреждений. Если установленный предел будет достигнут, то будет выведено предупреждение в окне информации. Параметры элементов фильтра ограничиваться не будет. **Фильтры на сосредоточенных элементах.** 



Если фильтр на сосредоточенных элементах, открывается окно **Lumped Model Options** рис. 1.9.

В этом окне на вкладке **Realization** имеются два списка: **Inductors** (Индуктивности) и **Capacitors** (Конденсаторы). В этих списках содержатся диапазоны значений индуктивностей и емкостей, которые могут использоваться в схемах.

iFilter может заменять идеальные элементы схемы реальными элементами. Например, в списке **Inductors** отметьте диапазон индуктивностей 0 - 1 **nH**. Справа от этого списка имеется переключатель возможных способов реализации индуктивности.

Если отмечено **INDQ/INDQP**, при анализе будет использоваться модель **INDQ** или **INDQP**.

Модель **INDQ** предполагает индуктивность с потерями. Модель **INDQP** кроме того учитывает собственную резонансную частоту **SRF**.

Рис. 1.9

Если отмечено Use AIR COIL, будет использоваться витая воздушная катушка. В этом случае вы должны определить максимальный радиус витка **Rmax[mm]** и тип провода **Wire**. iFilter будет искать катушку с максимальным радиусом и минимальным числом витков для требуемого значения индуктив-

Inductor Vendors and Parts			
	Available Types	Selected Types	
V ATC     V NIC       V AVX     V Panasonic       V Bourns     V Pulse       V Collcraft     V Samsung       Delevan     V Taiyo Yuden       DLI     V TDK       V EPCOS     V TOKO       V Fastron     V Venkel       V Fenghua     V Vishay       Ø Gowanda     Walsin       V Johanson     W Wurth       V KOA     Y Ageo       V Murata	ATC - 0402WL 0402-size wirewound inductors 22 parts: 1 - 47 nH	0402WL         0603WL         0805WL         1008WL         1206WL         AccuP-0603         AccuP-0603         AccuP-0905         CW160808         CW252016	
🖌 Select All 🛛 🖉 Select None		100 Sind Parts	
Part Sizes (EIA)       List of parts found:       100       Find Parts         V 01005       1008       List of parts found:       INDQ: L=1nH (ATC - 0402WL), Q=16.0, SRF=6GHz       INDQ: L=1nH (ATC - 0402WL), Q=30.0, SRF=20GHz         V 0201       1210       INDQ: L=1nH (Bourns - C1100505), Q=15.7, SRF=6GHz       INDQ: L=1nH (Bourns - C1100505), Q=18.0, SRF=21.3GHz         V 0603       V Other       INDQ: L=1nH (Columns - C1100505), Q=18.0, SRF=21.3GHz       INDQ: L=1nH (Columns - C1100505), Q=21.0, SRF=6GHz         V 0603       V Other       INDQ: L=1nH (COlumna - SML0603), Q=5.0, SRF=21.3GHz       INDQ: L=1nH (Gowanda - SML0603), Q=5.0, SRF=16GHz         V 0805       Select All       Select None       INDQ: L=1nH (Gowanda - SML0603), Q=5.0, SRF=13GHz         V Select All       Select None       INDQ: L=1nH (Gowanda - SML0603), Q=3.0, SRF=5GHz         Search for available types       Search for available types			
		OK Cancel	

Рис. 1.10

ности из выбранного диапазона значений.

Если отмечено Vendor Part, будет использоваться модель поставщика. Щелчок по кнопке Inductor Vendors открывает окно со списком поставщиков (рис. 1.10). В этом окне в области Vendors необходимо отметить тех поставщиков, которые доступны для вас. В области Part Sizes (EIA) отображается список доступных размеров элементов. Щелчок по кнопке Search for available types в левом нижнем углу обновит список доступных типов.

В области Selected Types приводится список выбранных типов. Щёлкая по кнопкам со стрелками слева от этой области, вы можете перенести любой из выбранных типов в список доступных типов Available Types. Ниже этих списков приводится краткие сведения о выделенном типе в списке Selected Types.

Если в поле L[nH] вве-

сти значение индуктивности, в поле **Freq** ввести частоту и щёлкнуть по **Find Parts**, то в списке ниже будут отображены все найденные индуктивности, которые могут работать на этой частоте.

Аналогичные операции можно выполнять и с элементами конденсаторов в области Capacitors окна рис. 1.9.

При использовании элементов поставщиков в их списках не всегда можно найти рассчитанные значения для всех L и C. Для подобных случаев в iFilter имеется две опции. Если в окне рис. 1.9 в области **Real L/C Parts** отметить **Split shunt capacitors into 2 if not realizable**, то iFilter будет автоматически искать пару конденсаторов, которые при параллельном соединении дадут требуемое значение ёмкости. Например, если нет конденсатора ёмкостью 3.7 pF, может быть найдена пара конденсаторов с емкостями 1 pF и 2.7 pF, которые при параллельном соединении дадут требуемую ёмкость 3.7 pF.

Если имеется LC резонатор и мы используем модели поставщиков, то можем не найти требуемых значений. В таком случае можно использовать вторую опцию **Keep resonance frequencies constant for LC's**. Допустим, мы получили необходимые значения L=1nH, C=3.8pF. Резонансная частота этого LC резонатора – 2.581 GHz. Самое близкое стандартное значение ёмкости конденсатора – 3.9pF. Т.к. резо-

Lumped Model Options	×
Realization Parasitics Limits	
Inductor and Capacitor Losses           QL         100         QC         1000           expL         0         expC         0	Self Resonance Frequency (SRF)           SRF [MHz]         10000         for Lref (1 nH)           SRF [MHz]         10000         for Cref (1 pF)
expFL Q(F)=Qv*(V/Vref)^expV*(F/Fref)^expFV Substitute L,C for V to get QL(F), QC(F) Lref=1nH, Cref=1pF, Fref=100MHz	SRF is used in analysis by using the relation: SRF = SRFref * (Vref/V)^0.5 where V=L or C, and "ref"s are given above. Example: If SRF=10GHz for 1nH, then SRF=5GHz for 4nH.
✓ Use fixed QL, QC values (simple) ✓ For BPF: set Q's to shunt resonators only	Use SRF in analysis (INDQP/CAPQP)
	ОК Отмена Применить

нение ёмкости конденсатора – 3.9рF. Т.к. резонансная частота не должна измениться, мы можем не включать опцию Split shunt capacitors into 2 if not realizable и включить опцию Keep resonance frequencies constant for LC's. В этом случае будет выбрано C=3.9рF и L=1.026nH.

В поле Min SRF/F0 ratio to look for вводится необходимое минимальное отношение собственной резонансной частоты элементов к средней частоте полосы пропускания фильтра. По умолчанию это отношение равно трём.

На вкладке **Parasitics** окна **Lumped Model Options** (рис. 1.11) определяются опции, влияющие на учёт потерь в фильтрах.

В области Inductor and Capacitor Losses в поля QL и QC вводятся значения добротностей индуктивности и ёмкости. Эти параметры можно определить двумя способами: простым и усовершенствованным. При

Рис. 1.11

простом способе значения Q считаются постоянными и независящими от частоты. Чтобы определить простой способ, отметьте Use fixed QL, QC vales (simple). В этом способе QL назначается всем индуктивностям, как отдельным, так и входящим в состав LC резонаторов. Аналогично QC назначается всем конденсаторам. Единственное исключение для полосовых фильтров, для которых можно назначить эти значения только для параллельных резонаторов, отметив For BPF: set Q's to shunt resonators only.

Чтобы установить усовершенствованный способ определения добротностей, снимите отметку Use fixed QL, QC vales (simple).

Ниже полей для ввода добротностей приведена формула, по которой рассчитываются усовершенствованные значения добротностей и замечание, что вместо V подставляются L или C для определения QL или QC.

В этом способе можно определить зависимость добротности от значений индуктивности или ёмкости и от частоты. Для этого нужно установить значения экспонент в полях expL, expC, expFL и

Lumped Model Opti	ons 🔀
Realization Parasitics L	imits
_ Ind/Cap Limits	
Min Inductance[nH]	0.1
Max Inductance[nH]	1e+006
Min Capacitance[uF]	1e-007
Max Capacitance[uF]	1000
Max L or C ratio	50
These limits are for warn If reached, they will be r	ning purposes only. aported in the information window.
The filter element values	will not be limited.
	ОК Отмена Применить

Рис. 1.12

**expFC**. Эти значения можно установить в пределах от -2 до 2 (целые числа).

В области Self Resonance Frequency (SRF) можно определить, нужно ли при анализе учитывать собственную резонансную частоту индуктивности и ёмкости. Для учёта SRF отметьте Use SRF in analysis (INDQP/CAPQP).

На вкладке Limits (рис. 1.12) определяются минимальные и максимальные значения индуктивности и ёмкости, а также максимальное отношение L к C.

В нижней части окна отображается поясняющая информация. На рис. 1.12 она поясняет, что эти пределы только для вывода предупреждений. Если установленный предел будет достигнут, то будет выведено предупреждение в окне информации. Значения элементов фильтра ограничиваться не будут.

### 1.4.2. Design Utilities (Утилиты проекта).

ТЫ.

В iFilter имеется несколько утилит, позволяющих выполнить некоторые вспомогательные расче-

Design Utilities 🛛 🛛					
VSWR Midband IL Air Coil Capacitance					
Passband ripple [dB]	0.1				
Return loss [dB]	16.427				
VSWR	1.3553				
Ref Coeff, rho	0.150				
Min ZLoad	36.890				
Max ZLoad	67.768				
ОК Отмена Применить					
Рис. 1.13					

На вкладке VSVR (рис. 1.13) можно пересчитать некоторые взаимно связанные параметры фильтра. Пересчитать можно следующие параметры:

**Passband ripple [dB]** – пульсации в полосе пропускания.

Return loss [dB] – возвратные потери.

VSWR – KCBH.

**Ref Coeff, rho** – Коэффициент отражения.

Min ZLoad – Минимальное сопротивление нагрузки.

**Max ZLoad** – Максимальное сопротивление нагрузки.

Изменение любого из трёх первых параметров обновит значения всех остальных параметров.







Design Utilities 🛛 🛛				
VSWR Midband IL Ai	ir Coil Capacitance			
Use round area ins	tead of square			
Square side [mm]	2	]		
Diameter [mm]		]		
Er	2.17	]		
Separation[mm]	0.127	]		
Capacitance [pF]	0.6051	]		
This dialog can calculate gap or pad capacitance: Use board thickness for pad capacitance. Use gap between plates for gap capacitance.				
	ОК	Отмена Применить		

Рис. 1.16

На вкладке **Midband IL** (рис. 1.14) можно оценить потери на отражение в середине полосы пропускания (midband) полосового фильтра.

Если изменить значение в поле Midband IL [dB], то будет вычислено и обновлено требуемое значение ненагруженной добротности в поле Unloaded Q.

На вкладке Air Coil (рис. 1.15) можно рассчитать параметры катушки индуктивности. Здесь могут быть рассчитаны минимальное и максимальное значения индуктивности, а также ненагруженная добротность. Индуктивность катушки зависит от зазора между витками. Lmin [nH] рассчитывается при отношении зазора к диаметру провода g/wd=2.0 (свободная намотка), Lmax [nH] рассчитывается при g/wd=0.5 (плотная намотка).

В поле **Number of turns** вводится количество витков.

В поле **Coil inner dia[mm]** вводится внутренний диаметр катушки.

В поле Frequency[GHz] вводится частота.

В поле Wire diameter [mm] вводится диаметр провода.

В поле Use AWG вводится тип используемого провода.

На вкладке **Capacitance** (рис. 1.16) можно рассчитать параметры конденсатора.

Если отметить Use round area instead of square, квадратные обкладки конденсатора будут заменены круглыми.

В поле Square side [mm] вводится сторона квадратной обкладки конденсатора.

В поле **Diameter** [mm] вводится диаметр круглой обкладки конденсатора.

В поле Er вводится диэлектрическая проницаемость диэлектрика.

В поле **Separation[mm]** вводится расстояние между обкладками конденсатора.

В поле **Capacitance** [**pF**] отображается рассчитанное значение ёмкости конденсатора.

### 1.4.3. Environment Options (Опции среды).

Щелчок по этой кнопке открывает окно Environment Options. На вкладке Units (рис. 1.17) можно установить используемые единицы измерения. На вкладке General (рис. 1.18) имеется только одна опция Flat buttons. Если её отметить, кнопки в окне будут отображаться плоскими, т.е. их границы не отображаются. Если эту опцию не отмечать, кнопки будут выпуклыми.

Environment O	ptions		×	Environment Options
Units General				Units General
Dimension —	Inductance —		Frequency	Flat buttons
Oum	ОuН	⊚uF	● MHz	
🖲 mm	⊚nH	OnF	GHz	
Omil	Орн	OpF		
() inch				
		ОК	Отмена Применить	ОК Отмена Применить
	Рис	. 1.17		Рис. 18

### 1.4.4. Generate Design (Генерировать проект).

При щелчке по этой кнопки открывает окно **Export Design** (рис. 1.19), в котором устанавливаются опции экспорта синтезированного фильтра в MWO.

В поле **Base Name** введите имя экспортируемого фильтра. Это имя будет присвоено экспортированной схеме. Все остальные окна в MWO (например, графики) будут использовать это имя, добавляя соответствующий текст в конце этого имени.

Export Design	🗵									
General Base Name Filter Overwrite existing items										
Schematic Use variables for element parameters Simplify schematic view by hiding Names Units Labels Minor params Snapping Grid	Analysis         ✓ Analyze after exporting         ✓ Use range below (not project defaults)         Fmin [MHz]       8000         Fmax [MHz       12000         # of steps       201									
Graphs Use fixed axis settings instead of Auto Export Insertion Loss + Return Loss Group Delay + Phase Insertion Loss + SWR Insertion Loss + Group Delay	Tuning and Optimization									
	OK Cancel									

Если в MWO уже есть схема с таким именем, будет выведено предупреждение, что такая схема уже существует. Если вы хотите заменить эту схему, отметьте **Overwrite existing items**.

В области **Schematic** определяются опции экспорта схемы.

Если отмечено Use variables for element parameters, параметры схемы экспортируются как переменные, для которых создаются уравнения. Параметры элементов схемы при этом определяются через созданные уравнения, записанные выше схемы.

Ниже этой опции имеется список некоторых элементов схемы (Simplify schematic view by hiding), которые можно скрыть для упрощения отображения схемы. Отмеченные в этом списке элементы не будут отображаться на схеме. Это Names (имена), Units (единицы измерений), Labels (метки), Minor params (несущественные параметры) и Snapping Grid (сетка привязки).

В области Graphs определяются типы графиков, которые можно экспортировать в MWO.

Если отмечено Use fixed axis settings instead of Auto, масштаб по оси Y будет фиксированным. В противном случае Microwave Office выбирает масштаб по оси Y в зависимости от диапазона единиц измерения.

В списке Export перечислены типы графиков, которые могут экспортироваться в MWO.

В области Analysis определяются опции для выполнения анализа в MWO.

Если отметить **Analyze after exporting**, анализ будет выполнен автоматически сразу же после экспорта.

Если отметить Use range below (not project defaults) для выполнения анализа экспортированной схемы будут использоваться частоты, переданные из iFilter. В противном случае будут использоваться частоты, установленные в проекте Microwave Office.

В поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] вводятся частоты, которые будут переданы в MWO для анализа. Щелчок по кнопке Set to current range устанавливает в этих полях текущий диапазон в iFilter.

В поле **# of steps** вводится количество частотных точек в диапазоне частот анализа, которое будет передано в MWO.

В области **Tuning and Optimization** вводятся опции, определяющие настройку и оптимизацию в MWO.

■ AWR VSS TDNN Model
 ■ iFilter Filter Wizard
 Eсли отметить Marc Tuning Variables, переданные в MWO переменные или параметры будут включены в выполнение настройки.

 Nuhertz Filter Wizard
 Рис. 1.20
 Если отметить Export Optimization Goals, в MWO будут переданы цели оптимизации. Чтобы эти цели были переданы в MWO, они должны быть установлены в iFilter. Это делается щелчком по кнопке Edit Chart Settings (верхняя кнопка слева от графика), о чём будет сказано ниже.

Установив все опции, нажмите OK, чтобы передать проект в MWO. При этом основное окно

Chart Settings	$\mathbf{X}$					
Plot           IL+RL           GD+PH           IL+SWR	D IL+PhVar					
Analysis Range         Fmin [MHz]       8000         Fmax [MHz]       12000         Fmax [MHz]       12000						
Markers and Opt Goals						
IL @ 10250MHz Auto						
- Delete X Clear						
OK Cancel Apply						

Add Markers / Opt Goa	s 🛛 🔀
Data Type	Frequency
<ul> <li>Insertion Loss</li> </ul>	Fmin [MHz] 9750
OReturn Loss	
O Group Delay	
O Insertion Phase	
OPhase Variation	
<b>○</b> VSWR	
Ovswr	OK Cancel

Рис. 1.21



Рис. 1.23

iFilter остаётся на экране. Его можно закрыть двумя способами. Нажатие на кнопку **Cancel** закрывает окно iFilter без сохранения созданного проекта в iFilter. При нажатии на **OK** созданный в iFilter проект сохраняется и его имя появляется как подгруппа в группе **iFilter Filter Wizard** (рис. 1.20). Щёлкнув по этому имени правой кнопкой мышки и выбрав **Edit**, можно снова открыть окно iFilter для редактирования.

### 1.5. Редактирование свойств графика.

Для редактирования свойств графика имеется ряд кнопок с левой стороны графика в основном окне iFilter.

Щелчок по кнопке Edit Chart Settings открывает окно Chart Settings рис. 1.21. В верхней части этого окна имеется область Plot с кнопками, щелчок мышкой по которым определяет тип создаваемого графика:

IL+RL – прямые и обратные потери.

**GD+PH** – групповое время задержки и фаза коэффициента передачи Ang(S21).

IL+SWR – прямые потери и КСВН по входу.

IL+GD – прямые потери и групповое время задерж-

КИ.

IL+PhVar – прямые потери и изменение фазы относительно линейной.

Чтобы отобразить нужный график, щёлкните по соответствующей кнопке и затем щёлкните по кнопке Apply в нижней части окна.

Обратите внимание, что такие же значки имеются в основном окне слева от графика. Они позволяют изменить тип графика, не заходя в окно **Chart Settings**.

В области Analysis Range в поля Fmin [MHz] и Fmax[MHz] вводятся минимальная и максимальная частоты для анализа. Если отметить Adjust range automatically when frequency specs are changed, граничные частоты для анализа будут автоматически изменены, если будет изменён частотный диапазон для фильтра (например, будет изменена полоса пропускания полосового фильтра в основном окне).

В области Markers and Opt Goals можно установить маркеры на графике и цели оптимизации.

Чтобы установить маркеры, щёлкните по кнопке Markers. В окне списка маркеров нужно ввести частоты, на которых требуется установить маркеры. Для этого щёлкните по значку Add ♣ Add справа от окна ввода. Откроется окно рис. 1.22. В области Data Type отметьте измеряемую величину, которую нужно отобразить на маркере. В поле Fmin [MHz] введите нужную частоту и нажмите OK.

Чтобы отредактировать маркер, выделите его в списке маркеров (рис. 1.21) и щёлкните по значку Edit. Чтобы маркер удалить, щёлкните по значку Delete. Чтобы удалить сразу все маркеры, щёлкните по значку Clear.

Если щёлкнуть по значку Auto, будут автоматически установлены маркеры для граничных частот и центральной частоты для полосно-пропускающих фильтров.

Если нужно установить цели оптимизации, щёлкните по значку **Opt Goals** и затем по значку **Add**. Откроется окно рис. 1.23.

В области Data Type установите нужную измеряемую величину для оптимизации. В области Frequency установите диапазон частот для цели оптимизации в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz]. В поле Level введите уровень измеряемой величины, к которому должен стремиться процесс оптимизации. Отметьте, где должно находиться значение измеряемой величины, больше установленного уровня Greater than (>) или меньше установленного уровня Less than (<). Нажмите OK.

Редактирование и удаление целей оптимизации делается так же, как и для маркеров. При щелчке по значку **Auto** автоматически устанавливаются цели в полосе пропускания и в полосе заграждения. Установленные цели оптимизации отображаются на графике.

В основном окне iFilter в нижней части окна графика слева от графика имеются ещё три кнопки.

— при нажатии на эту кнопку характеристика будет рассчитана для схемы с идеальными элементами. Для схемы на сосредоточенных элементах в МWO элементы передаются с их номинальными значениями, т.е. в схему передаются элементы **IND** и **CAP** для одиночных элементов или **SCL** и **PCL** для LC резонаторов.

— при нажатии на эту кнопку характеристика будет рассчитана для схемы с учётом потерь. Для схемы на сосредоточенных элементах в МШО элементы передаются с их номинальными значениями и значением добротности, т.е. в схему передаются элементы **INDQ** и **CAPQ** для одиночных элементов или **SCLQ** и **PCLQ** для LC резонаторов.

— при нажатии на эту кнопку характеристика будет рассчитана для схемы с реальными элементами. Если в схеме используются витые катушки индуктивности или элементы поставщиков, в МШО передаются элементы **INDQP** и **COIL**. Конденсаторы передаются как элементы **CAPQP**. Если элемент поставщика не имеет точной модели, анализ будет далёк от реального. В таком случае перед экспортом в МШО нужно вместо кнопки **REAL** выбрать кнопку **LOSSY**, или выбрать другого поставщика с более точной моделью.

В основном окне iFilter под графиком имеется ещё несколько кнопок.

При нажатии на кнопку 🔳 увеличивается диапазон частот для анализа.

При нажатии на кнопку 🖳 уменьшается диапазон частот для анализа.

При нажатии на кнопку (Narrow Analysis Span – узкий диапазон анализа) диапазон анализа сужается и выполняется вблизи полосы пропускания для полосно-пропускающих фильтров или вблизи полосы заграждения для полосно-заграждающих фильтров.

При нажатии на кнопку 🖽 (Wide Analysis Span – широкий диапазон анализа) – выполняет анализ в широком диапазоне частот.

При нажатии на кнопку (Passband Analysis Span – диапазон анализа полосы пропускания) диапазон анализа ограничивается полосой пропускания или полосой заграждения для соответствующих



типов фильтров.

При нажатии на кнопку (Ultra Wide Analysis Span – сверхширокий диапазон анализа) – устанавливает очень широкий диапазон для анализа.

При нажатии на кнопку (Auto Snap when Passband Changes) автоматически выполняется новый синтез и анализ, если изменена частота или полоса пропускания в области Specifications, аналог нажатию клавиши Enter.

Нажимая на кнопку (Show/Hide Major Graph Grids) можно отобразить/скрыть крупную сетку на графике.

Нажимая на кнопку (Show/Hide Minor Graph Grids) можно отобразить/скрыть мелкую сетку

на графике.

На рис. 1.24 показан график с крупной и мелкой сеткой. Заметим, что эта сетка на графике может быть почти незаметной (на рис. 1.24 увеличена контрастность в графическом редакторе).

Нажав на кнопку 🔶 Add, можно установить маркеры.

## 1.6. Отображение результатов синтеза.

В правой нижней части основного окна расположена область для отображения результатов синтеза фильтра.

Рядом с этой областью с левой стороны расположены кнопки, определяющие, что должно быть отображено.

- View Circuit Schematic. Отображает схему фильтра.

¥

-UNU-

View Layout. Отображает топологию фильтра для фильтров на распределённых параметрах.

— View Circuit Information. Отображает информацию об элементах схемы и возможные ошибки в проекте.

**View Physical Dimension**.Отображает физические единицы для элементов схемы (ширину и длину отрезков линий и пр.) и возможные ошибки в проекте.

Если у синтезированного фильтра получились недопустимые или нереализуемые параметры, значки отображения топологии и информации будут красного цвета (рис. 1.25). Значком красного цвета будут от-

mτα	· ◎ Technology: Microstrip (H=0.5mm, Er=9.8, T=0.005mm, Hu=0mm)
<u> </u>	◎ Parts
JINIL	• TLN: W=0.4854mm, L=2.9416mm
010	• STEP: W1=0.4854mm, W2=0.1377mm, Offset=-0.173mm
ma	PCL: W=0.1377mm, S=0.0763mm, L=5.9901mm, (err#1252: Spacing too narrow)
	• STEP: W1=0.1377mm, W2=0.2672mm, Offset=-0.064mm
Luces	• PCL: W=0.2672mm, S=0.1101mm, L=5.8926mm
-0	• STEP: W1=0.2672mm, W2=0.3434mm, Offset=-0.038mm
	Рис. 1.25

мечены и строки в окне информации, а в скобках в такой строке указана причина ошибки. На этом рисунке в строке, отмеченной значком красного цвета, в скобках сообщается, что зазор очень мал. Однако это только предупреждающее сообщение. Анализ будет выполняться, и такой фильтр может быть передан в MWO для моделирования.

Замечание. Перед открытием программы iFilter в MWO желательно установить те единицы измерения, которые вы будете использовать в iFilter. Однако это не обязательно, их можно будет изменить в любое время.

# 2. Примеры синтеза.

### 2.1. Синтез фильтров на сосредоточенных элементах.

### 2.1.1. Полосно-пропускающий фильтр.

Требования: полоса пропускания 475 – 525 МГц, потери в полосе не более 4 дБ, уровень пульсаций в полосе пропускания 0.01 дБ, ослабление на частоте 600 МГц не менее 50 дБ.

Environment (	Options		×					
Units General								
Dimension —	Inductance —		Frequency					
Oum	OuH	OuF	● MHz					
() mm	<b>⊙</b> nH	OnF	GHz					
Omil	Орн	⊙pF						
Oinch								
ОК Отмена Применить								
Рис. 2.1								



Разверните группу Wizards и дважды щёлкните по iFilter Filter Wizard.

В основном окне в области **Design Control** щёлкните по кнопке **Environment Options**. В открывшемся окне на вкладке **Units** выберите единицы измерения, как показано на рис. 2.1.

На вкладке General можно снять отметку в Flat buttons, чтобы лучше были видны кнопки в основном окне.

В основном окне в области **Туре-Approximation** щёлкните по верхней кнопке для выбора типа фильтра. В открывшемся окне **Select Filter Type** отметьте **Bandpass** и **Lumped**.

В левом окне списка типов фильтра Main Filter Type отметьте Narrowband Lumped Filter (Узкополосный фильтр).

В правом окне списка опций **Options** отметьте **Capacitive (identical shunt L)** – емкостной (идентично параллельной L) для синтеза фильтра с емкостными связями. Щёлкая по различным опциям в этом окне, вы можете видеть разницу в типах фильтра. Нажмите **OK**.

Щёлкните по второй кнопке в основном окне в области **Type-Approximation** и выберите тип характеристики **Chebyshev**.

В поле **Ripple[dB]** введите величину пульсаций в полосе **0.01**.

В области Specifications введите порядок фильтра (Degree) 5, центральную частоту (F0[MHz])

**500**, ширину полосы пропускания (**BW**[**MHz**]) **50**, сопротивления источника и нагрузки **50**.

Нажмите клавишу Enter или щёлкните по значку Auto под графиком. Синтез и анализ будут выполнены.

Слева от графика нажмите на кнопку Insertion Loss and

Return Loss . Затем нажмите на кнопку IDEAL.

Внизу под графиком отметьте кнопку WS, чтобы установить широкую полосу частот для анализа.

Внизу под графиком щёлкните по кнопке Add, чтобы добавить маркеры. В открывшемся окне рис. 2.2 в области Data Type отметьте Insertion Loss, в поле Fmin [MHz] введите 500, нажмите Ok. Аналогично добавьте второй маркер на частоте 600 МГц.

Основное окно будет выглядеть, как показано на рис. 2.3.

![](_page_13_Figure_22.jpeg)

200

Type - Approximation

Narrowband Lumped

Chebyshev

![](_page_13_Figure_23.jpeg)

InsLoss[dB]

0

10

Рис. 2.3

RetLoss[dB]

500

0

5

![](_page_14_Figure_0.jpeg)

Требование на частоте 600 МГц не выполняется. Чтобы его выполнить, нужно увеличить порядок фильтра. При этом увеличатся потери в полосе пропускания. Чтобы их уменьшить, можно несколько расширить полосу. Введите 6 в **Degree** и 55 в **BW[MHz]**. Схема будет выглядеть, как показано на рис. 2.4, а график – на рис. 2.5.

Обратите внимание, в этом типе фильтра все индуктивности в резонаторах имеют одно и тоже значение индуктивности. Т.е. в фильтре потребуется только один тип катушки индуктивности.

Оценить влияние возможных потерь можно двумя способами. Можно оценить возможные добротности индуктивности и конденсаторов и использовать их. Щёлкните по кнопке **Design Utilities** в основном окне iFilter. В открывшемся окне рис. 2.6 на вкладке **Air Coil** (витая катушка) введите 1 в поле **Number of Turns** (количество витков), 1 в поле **Coil inner dia[mm]** (внутренний диаметр), **500** в поле **Frequency[MHz]**. В поле **Use AWG** введите тип провода **awg32** (американский стандарт), который имеет диаметр 0.2 мм. Получаем, что можно ожидать добротность катушки 90. Закройте оно.

Покупные конденсаторы можно найти с добротно-

SRF [MHz]

SRF [MHz]

Self Resonance Frequency (SRF

Example: If SRF=10GHz for 1nH, then SRF=5GHz for 4nH. Use SRF in analysis (INDOP/CAPOP)

ОК

10000

SRF is used in analysis by using the relation: SRF = SRFref \* (Vref/V)^0.5 where V=L or C, and "ref"s are given above.

for Lref (1 nH)

for Cref (1 pF)

Отмена Применить

Рис. 2.5

esign Utilities 🛛 🕅	Lumped Model Options
	Realization Parasitics Limits
Volune Infinite and the capacitance	Inductor and Capacitor Losses
Number of turns 1 Wire diameter[mm] 0.2032	QL 92 QC 350
Coil inner dia[mm] 1 Use AWG awg32 (0.20mm)	expL 0 expC 0
	expFL 0 expFC 0
	Q(F)=Qv*(V/Vref)^expV*(F/Fref)^expFV
N Lmin[nH] Lmax[nH] Qu	Substitute L,C for V to get QL(F), QC(F) Lref=1nH, Cref=1pF, Fref=100MHz
1.0 1.914 1.914 90.0	
1.5 2.367 3.055 90.0	Use fixed QL, QC values (simple)
2.0 4.209 5.431 90.0	For BPF: set Q's to shunt resonators on
Notes:	
Lmin calculated with g/wd=2.0	
Lmax calculated with g/wd=0.5 🛛 🔤	
ОК Отмена Применить	L
Рис. 2.6	Рис

![](_page_14_Figure_6.jpeg)

Щёлкните по кнопке Design Options в основном окне iFilter. В отрывшемся окне на вкладке

стью 350 на частоте 500 МГц.

![](_page_14_Figure_8.jpeg)

в основном окне ігплег. В отрывшемся окне на вкладке Parasitics рис 2.7 в поле QL введите 90, в поле QC введите 350. На вкладке Realization в области Inductors отметьте (1–10 nH) и отметьте переключатель INDQ/INDQP. В области Capacitors отметьте (0-10pf) и отметьте CAPQ/CAOQP. Затем отметьте (10-100pf) и отметьте CAPQ/CAOQP. Нажмите Применить и OK. Щёлкните по кнопке Lossy слева от графика. Полученный график с учётом потерь показан на рис. 2.8.

Влияние потерь можно также учесть, используя данные поставщиков элементов.

Щёлкните по кнопке Design Options в основном окне iFilter. На вкладке Realization в области Inductors отметьте (1–10nH) и отметьте переключатель Vendor Part. Затем щёлкните по кнопке Inductor Vendors. Откроется окно рис. 2.9. Допустим, вы используете индуктивности типа 0805 от Bourns. В окне рис. 2.9 щёлкните по кнопке Select None, чтобы в списке поставщиков Vendors снять все "галочки". Затем в этом списке отметьте Bourns. Если список типов индуктивностей находится в области Selected Types, щёлкните по значку

слева от этого списка, чтобы перенести список в

область Available Types. В области Part Sizes (EIA) щёлкните по Selected None, чтобы снять все отметки, и затем отметьте 0805. После этого щёлкните по кнопке Search for available types. В списке Avail-

able Types останутся только индуктивности нужного типа. Щёлкните по значку cnpaвa от этого списка, чтобы перенести эти индуктивности в область Selected Types. В поле L[nH] введите 2.25, в поле Freq введите 500 и щёлкните по кнопке Find Parts. Ниже будет отображён список найденных индуктивностей, наиболее близких к заданным параметрам. Выберите в этом списке наиболее подходящий тип и отметьте его в области Selected Types. Нажмите OK, чтобы закрыть это окно.

Inductor Vendors and Parts 🛛 🛛 🔀	Capacitor Vendors and Parts
Inductor Vendors and Parts         Vendors         ATC       NIC         AVX       Panasonic         VBourns       Pulse         Coloraft       Samsung         Delevan       Taiyo Yuden         DUU       TDK         DUU       TDK         EPCOS       TOKO         Fastron       Verkel         Fenghua       Vishay         Gowanda       Walsin         Johanson       Wurth         KOA       Yageo         OBO5-size multilayer inductors         31 parts: 1.5 - 470 nH         Vert Select All       Select None         List of parts found:         INDQ: L=2.2nH (Bourns - CW201212), Q=36.4, SRF=6GHz         INDQ: L=2.2nH (Bourns - CW201212), Q=40.3, SRF=4GHz	Capacitor Vendors and Parts       X         Vendors       Att         Att       Nic         Att       Parasonic         Bourns       Pulse         Collcraft       Samsung         Delevan       Tatyo Yuden         Delui       Ttok         EPCOS       Toko         Fenghua       Vishay         Gowada       Waish         Johanson       Wurth         KOA       Yageo         Murata       Select All         Select All       Select None         CipF]       3.2         Part Sizes (EIA)       List of parts found:         List of parts found:       CAP: C=3.3pF (Murata - GCM15), Q=216.0, SRF=4.01G+z         CAP: C=3.3pF (Murata - GCM15), Q=2216.0, SRF=4.4040-z         Capito - 2.000       Capito - 2.000
Part Szes (EIA)       Iuos         01005       1008         03015       1206         03015       1210         0402       1812         0603       Other         ✓ Select All       Select None         Search for available types       CK	Part Sizes (EIA)       List of parts found:       CAP: C=3.3pF (Murata - GCM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz         0:0005       1206       CAP: C=3.3pF (Murata - GM03), Q=620.6, SRF=4.01GHz         0:0001       1210       CAP: C=3.3pF (Murata - GM03), Q=621.6, SRF=4.01GHz         0:0003       0 ther       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM03), Q=216.0, SRF=4.01GHz         0:0005       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM03), Q=216.0, SRF=4.01GHz         0:0005       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz         CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz         CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz         CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz         CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz         Search for available types       CAP: C=3.3pF (Murata - GRM15), Q=216.0, SRF=4.01GHz

Рис. 2.9

Рис. 2.10

В области Capacitors отметьте Vendor Part и в окне списка диапазонов значений ёмкости выберите (0–10pF) и щёлкните по кнопке Capacitor Vendors. Тоже самое сделайте для (10–100pF). В открывшемся окне аналогично выберите поставщика и тип конденсаторов (рис. 2.10), нажмите OK, чтобы вернуться в окно Lumped Model Options.

# В окне опций отметьте Split shunt capacitors into 2 if not realizable, щёлкните Применить и ОК.

Заметим, что списки конкретных элементов со значением их параметров являются скорее справочными. iFilter среди выбранных типов элементов поставщиков, которых можно отметить несколько, ищет наиболее подходящие с самой высокой добротностью.

![](_page_15_Figure_8.jpeg)

Нажмите кнопку **REAL** слева от графика. Полученный график показан на рис. 2.11.

![](_page_15_Figure_10.jpeg)

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

-20

-40

-60

-80

300

400

500

Frequency (MHz)

Рис. 2.15

Insertion Loss

Характеристика, рассчитанная с реальными элементами, может сильно отличаться от идеальной характеристики или рассчитанной с потерями из-за того, что не всегда поставщики представляют точные модели своих элементов.

Теперь можно экспортировать схему фильтра в Microwave Office. В основном окне iFilter щёлкните по кнопке Generate Design. В открывшемся окне рис. 2.13 отметьте Minor params, чтобы строки с параметрами не затемняли схему. Отметьте опции Use variables for element parameters и Mark Tuning Variables, чтобы параметры схемы были переданы как переменные и можно было выполнить настройку схемы. Нажмите OK. Схема будет передана в MWO (рис. 2.14). Закройте окно iFilter, нажав OK в этом окне.

![](_page_16_Figure_3.jpeg)

-10

-20

-30

-40

700

Return Loss

DB(|S(1,1)|) (R)

iFilter

600 MHz

-55.81 dB

В МШО в схему переданы элементы **САРQP** и **INDQP**. Дважды щёлкните по любому из этих элементов, чтобы открыть окно свойств. Значение ёмкости для элемента конденсатора и добротность заданы в векторном виде, определяющем их зависимость от частоты. Аналогично определены параметры и для элемента индуктивности. Назначить такие параметры для настройки или оптимизации нельзя. Это можно сделать только для паразитной индуктивности у конденсаторов и паразитной ёмкости у индуктивностей. Поэтому при экспорте в МШО не создавались переменные для настройки и оптимизации, хотя в опциях экс-

порта отмечены опции Use variables for element parameters и Mark Tuning Variables. В поле Part Number окна свойств элементов отображается используемый поставщик.

Отредактировать параметры элементов можно и вернувшись в iFilter.

600

Допустим, вы решили экспортировать схему в MWO так, чтобы можно было выполнить настройку. Для этого нужно отказаться от использования в схеме реальных элементов поставщиков.

Щёлкните по имени схемы iFilter в группе iFilter Filter Wizard правой кнопкой мышки и выберите Edit.

Щёлкните по кнопке Design Options. На вкладке Realization в списке Inductors для значений (1 – 10nH) отметьте INDQ/INDQP, в списке Capacitors для значений (0 – 10pF) и (10 – 100pF) отметьте CAPQ/CAPQP, нажмите Применить и OK.

В основном окне iFilter щёлкните по кнопке Lossy слева от графика.

Щёлкните по кнопке Generate Design. Отметьте Overwrite existing items, если хотите заменить имеющуюся схему с прежним именем, а не создавать новую. Нажмите OK. Затем нажмите OK в основном окне iFilter. В MWO будет передана схема, показанная на рис. 2.16.

![](_page_17_Figure_1.jpeg)

![](_page_17_Figure_2.jpeg)

### 2.1.2. Фильтр нижних частот.

Требования: частота среза 250 МГц, ослабление на частоте 450 МГц – 70 дБ, пульсации в полосе пропускания 0.1 дБ.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Lowpass и Lumped, нажмите OK.

Щёлкните по кнопке типов характеристик и выберите Elliptic. Нажмите Apply и OK.

Введите 0.1 в поле Ripple[dB].

В области Specifications введите 5 в поле degree, 250 в поле Fp[MGz], 70 в поле Stopb.IL[dB]. Щёлкните по значку IDEAL слева от графика.

Щёлкая по кнопке Add под схемой, установите маркеры на частотах 250 и 450 МГц.

Щёлкните по кнопке **WS**, чтобы установите широкую полосу частот для анализа

Основное окно будет выглядеть, как показано на рис. 2.17.

![](_page_17_Figure_12.jpeg)

### Рис. 2.17

Рис. 2.18

На частоте 450 МГц требование не выполняется. Чтобы увеличить ослабление на этой частоте, измените порядок фильтра (**Degree**) на 7 и нажмите клавишу **Enter** или щёлкните по значку **Auto** ниже графика. График будет выглядеть, как показано на рис. 2.18.

Щёлкните по кнопке **Design Options** и установите способы реализации индуктивностей и конденсаторов для заданных диапазонов значений, при желании выберите поставщиков. Например, для индуктивностей в диапазонах значений (1 - 10nH), (10 - 50nH) и (50 - 100nH) выберите витые катушки Use AIR COIL, для конденсаторов в диапазоне (10 - 100pF) выберите CAPQ/CAPQP (рис. 2.19). Щёлкните по кнопке **Применить** и затем по кнопке **OK**. Щёлкните по кнопке Generate Design. В открывшемся окне рис. 2.20 отметьте нужный тип графика, отметьте Use variables for element parameters и Mark Tuning Variables, Щёлкните по кнопке Set to current range и нажмите OK. Затем нажмите OK в основном окне iFilter.

![](_page_18_Figure_1.jpeg)

Рис. 2.19

Рис. 2.20

![](_page_18_Figure_4.jpeg)

![](_page_18_Figure_5.jpeg)

### 2.2. Синтез микрополосковых фильтров.

### 2.2.1. Фильтр нижних частот с частотой среза 2 ГГц.

Требования: частота среза 2 ГГц, ослабление на частоте 4 ГГц не менее 20 дБ, подложка – поликор, h=1 мм.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Lowpass и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Stepped Impedance Lowpass Filter (ступенчатый низкочастотный фильтр). В списке Options отметьте Same Length, varying Z's (одинаковая длина, переменные Z). Нажмите OK.

Щёлкните по кнопке типа характеристики и отметьте Chebyshev.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

Введите 0.1 в поле Ripple[dB].

В области Specifications введите 5 в поле degree, 2 в поле Fp[GHz], 30 в поле ElecLng[deg] (электрическая длина в градусах).

Щёлкая по кнопке Add под схемой, установите маркеры на частотах 2 и 4 ГГц.

Щёлкните по верхней кнопке Edit Chart Settings слева от графика. В открывшемся окне Chart Setting в области Analysis Range в поле Fmin [GHz] введите 0, в поле Fmax [GHz] введите 6 (диапазон для анализа), нажмите кнопку IL+RL (тип графика), нажмите Apply и OK.

В области Design Control щёлкните по кнопке Design Options. Откроется окно Distributed Model Options.

На вкладке Realization отметьте Add input and output lines to the layout (добавить линии на входе и выходе топологии).

![](_page_19_Figure_0.jpeg)

![](_page_19_Figure_1.jpeg)

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

На вкладке Technology (рис. 2.23) в поле Substrate Er введите 10.2, в поле Height(H)[mm] (толщина подложки) введите 1, в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.005, в поле Loss Tangent (tandD) введите 0.001.

В нижней части окна отображается информация о частотах, на которых возникнут высшие типы волн, а также ширина проводника для различных волновых сопротивлений.

### Нажмите Применить и ОК.

Слева от графика нажмите кнопку **REAL**.

Замечание. Обратите внимание, если нажата кнопка IDEAL, то при экспорте в MWO, параметры отрезков линий будут переданы в волновых сопротивлениях и в электрических длинах. Если нажата кнопка REAL, параметры отрезков линий (длина и ширина) будут переданы в

единицах длины (мм).

Основное окно будет выглядеть, как показано на рис. 2.24. В нижней части окна в области отображения результатов синтеза в данном случае отображается схема фильтра.

Обратите внимание на отображение кнопок View Layout и View Physical Dimension слева от схемы. Они отображаются красным цветом. Это означает, что в топологии имеются нереализуемые параметры или другая ошибка.

Щёлкните по кнопке View Physical Dimension. В области отображения результатов синтеза будут отображены параметры синтезированной физической модели (рис. 2.25). Здесь возле некоторых элементов TLIN красным цветом отображён

символ W в квадратике, что означает, что нужно обратить внимание на ширину проводника W. В этой же строке дано рассчитанное значение W=0.1mm и в скобках пояснение, что  $Z_0$  слишком велико

Однако анализ выполняется и, при желании, вы можете передать эти данные в MWO и там отредактировать нереализуемые размеры и выполнить настройку фильтра. Но устранить это можно и в iFilter.

В поле **ElecLng[deg]** установите **35**. Ширина проводника будет увеличена и все предупреждения исчезнут.

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

Рис. 2.26

Передайте синтезированную схему в МWO. Для этого щёлкните по кнопке Generate Design.

Откроется окно с опциями экс-порта (рис. 2.26).

В области General в поле Base Name введите имя для экспортированной схемы, например Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items, если хотите заменить существующую схему с таким же именем.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters, если хотите, чтобы в МWО были созданы переменные для настройки схемы. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto, если хотите, чтобы масштаб по оси Y был фиксированным, а не устанавливался автоматически в зависимости от рассчи-

танного диапазона единиц измерений. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis не отмечайте Analyze after exporting (Анализировать после экспорта). Если отметить эту опцию, то анализ будет выполнен автоматически сразу после экспорта, что обычно удобно. Однако если схема экспортирована с ошибкой, что иногда бывает, анализ выполняться не будет с выводом сообщения об ошибке. Отметьте Use range below (not project defaults), чтобы для анализа использовать частоты, переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте.

В этой же области в поля **Fmin** [MHz] и **Fmax** [MHz] введите минимальную 0 и максимальную 6000 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter.

В области Tuning and Optimization отметьте Mark Tuning Variables, чтобы назначить переменные для настройки. В поле # of steps введите количество точек для анализа 201.

Нажмите **OK**. Окно с опциями экспорта в MWO будет закрыто. Нажмите **OK** в основном окне iFilter. Это окно будет закрыто и в MWO появятся экспортированные схема (рис. 2.27) и пустой график.

![](_page_20_Figure_12.jpeg)

![](_page_20_Figure_13.jpeg)

Как видно на рис. 2.27, в схеме созданы переменные, которые включены для настройки (эти пе-

ременные отображаются синим цветом), и вы можете выполнять настройку. Однако не все переменные включены в настройку. Поэтому щёлкните по значку **Tune Tool** на панели инструментов и затем, щёлкая по переменным, отображённым чёрным цветом, включите их в настройку.

В глобальных единицах измерения (Options>Project Options>Global Units) установите единицу измерения частоты GHz.

Щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов, чтобы выполнить анализ в MWO. Рассчитанный график показан на рис. 2.28.

Чтобы сравнить графики до и после настройки, сделайте копию схемы. Установите

курсор на имя схемы в окне просмотра проекта, нажмите левую кнопку мышки и перетащите имя схемы на Circuit Schematics. Будет создана копия схемы с именем Filter\_1.

Откройте предыдущую схему Filter, щёлкните по значку Tune Tool на панели инструментов и затем, щёлкая по переменным, отображённым синим цветом, исключите их из настройки.

Откройте окно графика.

Чтобы на графике видеть характеристики обеих схем, щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB(|S(2,1)|) в группе Filter IL IR в окне просмотра проекта и выберите Properties. В открывшемся окне в поле Data Source Name введите All Sources и нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter: DB(|S(1,1)|).

Щёлкните по значку **Tune** на панели инструментов. Перемещая движки на блоке настройки, подстройте схему. При этом учитывайте размер ячеек сетки для будущей электромагнитной структуры. Выберем размер ячеек 0.05 мм по осям X и Y. Тогда размеры должны быть кратными 0.05 м. Вариант характеристики схемы после настройки показан на рис. 2.29.

![](_page_21_Figure_5.jpeg)

![](_page_21_Figure_6.jpeg)

Первичная схема Filter больше не нужна и её можно удалить.

Откройте окно схемы Filter\_1 и щёлкните по значку View Layout на панели инструментов. Откроется окно топологии схемы. Выберите в меню Edit>Select All, чтобы выделить всю топологию, и щёлкните по значку Snap Together на панели инструментов, чтобы исправить отображение топологии. Полученная топология схемы показана на рис. 2.30.

![](_page_21_Figure_9.jpeg)

Щёлкая по значку **Measure** на панели инструментов, измерьте размеры топологии, они получились 39.8 х 5.3.

Щёлкните по значку Add New EM Structure на панели инструментов.

Введите имя структуры FN, отметьте симулятор AWR EMSight Simulator и нажмите Create. Щёлкните по значку Substrate Information на панели инструментов.

На вкладке Enclosure в поле X\_Dim введите 39.8, в поле Y\_Dim введите 7.2, в поля Grid\_X и Grid\_Y введите 0.05.

На вкладке Material Defs введите Er=10.2, TanD=0.001.

На вкладке Dielectric Layers введите толщину 1-го слоя (Air) 6 мм, толщину второго слоя (Diel\_1) 1 мм. Нажмите OK.

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и щёлкните по значку Сору на панели инструментов.

Откройте окно электромагнитной структуры и щёлкните по значку **Paste** на панели инструментов. Вставьте скопированную структуру в корпус, симметрично относительно боковых стенок.

При всей выделенной топологии щёлкните по любому элементу топологии правой кнопкой мышки, выберите Shape Properties и введите 2 для слоя EM Layer и материал 1/2oz Cu. Нажмите OK.

Выделяя входной и выходной проводники и щёлкая по значку Edge Port на панели инструментов, добавьте порты на входе и выходе со сдвигом референсных плоскостей 2 мм. Для этого дважды щёлкните по установленному порту мышкой и введите 2 в поле Ref. Plane Distance. Должна получиться структура, показанная на рис. 2.31.

![](_page_21_Figure_20.jpeg)

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры FN и выберите Options. На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults. Отметьте Replace, в поле Start [GHz]

введите 0, в поле Stop [GHz] введите 6, в поле Step [GHz] введите 0.5 и нажмите Apply. На вкладке EM-Sight отметьте Enable AFS и нажмите OK. Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.32.

![](_page_22_Figure_1.jpeg)

Чтобы просмотреть график более подробно, добавьте ещё несколько частот. Снова щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры FN и выберите Options. На вкладке Frequencies замените шаг на 0.1 и нажмите Apply и OK. Щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.33. Обратите внимание, что при включённом AFS добавление точек внутри диапазона, анализ в добавленных точках не выполняется, значения в этих точках определяются аппроксимацией полученных ранее результатов.

В данном случае результаты электромагнитного анализа хорошо совпадают с результатами схемного анализа.

### 2.2.2. Фильтр нижних частот с частотой среза 10 ГГц.

Требования: частота среза 10 ГГц, ослабление на частоте 16 ГГц не менее 40 дБ, подложка – R04003C толщиной h=0.305 мм.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Lowpass и Microstrip.

В списке Main Filter Type отметьте Optimum Distributed Lowpass Filter (оптимальный распределённый низкочастотный фильтр). В списке Options отметьте 20dB Return Loss (20 дБ обратные поте-

![](_page_22_Figure_8.jpeg)

Рис. 2.34

![](_page_22_Figure_10.jpeg)

Слева от графика нажмите кнопку REAL.

ри). Нажмите OK. Щёлкните по кнопке Environment Options,

на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

В области Specifications введите 7 в поле degree, 10 в поле Fp[GHz], 40 в поле ElecLng[deg] (электрическая длина в градусах).

Щёлкая по кнопке Add под схемой, установите маркеры на частотах 10 и 16 ГГц.

Щёлкните по кнопке NS ниже графика.

В области **Design Control** щёлкните по кнопке **Design Options**.

На вкладке Realization отметьте Add input and output lines to the layout и Splint shunt impedances if smaller then Zmin, введите в поле ввода 30.

На вкладке Technology (рис. 2.34) в поле Substrate Er введите 3.55, в поле Height(H)[mm] (толщина подложки) введите 0.305,в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите

![](_page_23_Figure_0.jpeg)

Основное окно со схемой в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.35. по

ванная топология пока-Передайте син-

тезированную схему в MWO. Для этого шёлкните по кнопке Generate

Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта (рис. 2.37).

В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items.

области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы. желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

области

fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return

В области Analysis отметьте Analyze design after generation, чтобы анализ был выполнен сразу после передачи схемы в MWO, и Use range below (not project defaults), чтобы для

переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте.

поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 0 и максимальную 20000 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие час-

В области Tuning and **Optimization** отметьте Mark Tuning Variables, чтобы назначить переменные для настройки. В поле # of steps введите количество точек для анализа 201.

Нажмите ОК. Затем нажмите ОК в окне программы iFilter. В MWO будет передана схема, показанная на рис. 2.38.

![](_page_23_Figure_14.jpeg)

✓ Insertion Loss + Return Loss

Insertion Loss + Group Delay

Group Delay + Phase Insertion Loss + SWR

OK

Cancel

![](_page_24_Figure_0.jpeg)

График будет выглядеть, как показано на рис. 2.39. Эта характеристика получена при значениях переменных, показанных на рис. 2.40 и она удовлетворяет поставленным требованиям.

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

Откройте окно схемы и, дважды щёлкая по значениям переменных, отредактируйте значения переменных так, чтобы они были кратными 0.05 мм (рис. 2.41).

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке **Analyze** на панели инструментов. Убедитесь, что график почти не изменился.

Откройте окно схемы Filter и щёлкните по значку View Layout на панели инструментов. Откроется окно тополо-

гии схемы. Выберите в меню Edit>Select All, чтобы выделить всю топологию, и щёлкните по значку Snap Together на панели инструментов, чтобы исправить отображение топологии. Полученная топология схемы показана на рис. 2.42.

![](_page_24_Figure_7.jpeg)

Щёлкая по значку **Measure** на панели инструментов, измерьте размеры топологии, они получились 14.45 х 4.175.

Щёлкните по значку Add New EM Structure на панели инструментов. Введите имя структуры FN, отметьте симулятор AWR EMSight Simulator и нажмите Create.

Щёлкните по значку Substrate Information на панели инструментов.

На вкладке Enclosure в поле X\_Dim введите 14.45, в поле Y\_Dim введите 5, в поля  $Grid_X$  и Grid\_Y введите 0.05.

На вкладке Material Defs введите Er=3.55, TanD=0.0027.

На вкладке Dielectric Layers введите толщину 1-го слоя (Air) 2 мм, толщину второго слоя (Diel\_1) 0.305 мм. Нажмите OK.

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и щёлкните по значку Сору на панели инструментов.

Откройте окно электромагнитной структуры и щёлкните по значку **Paste** на панели инструментов. Вставьте скопированную структуру в корпус, симметрично относительно боковых стенок. Выделите входной проводник, щёлкните по значку **Edge Port** на панели инструментов, добавьте порт на входе фильтра. Сдвиньте референсную плоскость на 1 мм. Для этого дважды щёлкните по установленному порту мышкой и введите 1 в поле **Ref. Plane Distance**. Аналогично установите порт на выходе фильтра. Должна получиться структура, показанная на рис. 2.43.

![](_page_25_Figure_1.jpeg)

Рис. 2.43

Выделите всю топологию, щёлкните правой кнопкой мышки по любому выделенному элементу и выберите Shape Properties. В открывшемся окне свойств введите 2 в поле EM Layer, введите материал 1/202 Cu и нажмите OK.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB(|S(2,1)|) в группе Filter IL IR в окне просмотра проекта и выберите Properties. В открывшемся окне в поле Data Source Name введите All Sources. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter: DB(|S(1,1)|).

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры FN и выберите Options. На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults. Отметьте Replace, в поле Start [GHz] введите 0, в поле Stop [GHz] введите 20, в поле Step [GHz] введите 1, нажмите Apply.

На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.44.

![](_page_25_Figure_8.jpeg)

Чтобы просмотреть график более подробно, добавьте ещё несколько частот. Снова щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры FN и выберите Options. На вкладке Frequencies замените шаг на 0.1, нажмите Apply и OK. Полученный график показан на рис. 2.45.

### 2.2.3. Полосно-пропускающий фильтр с боковыми связями 3 – 3.1 ГГц.

Требования: пятирезонаторный фильтр с полосой пропускания 3 – 3.1 ГГц на материале R04003C толщиной 0.305 мм.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandpass и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Edge Coupled Bandpass Filter. В списке Options отметьте Standard. Нажмите OK.

Щёлкните по второй кнопке в области Type-Approximation и выберите тип характеристики Chebyshev.

В поле **Ripple[dB]** введите величину пульсаций в полосе **0.1**.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

![](_page_26_Figure_0.jpeg)

![](_page_26_Figure_1.jpeg)

а поле RSource.

Щёлкните по верхней кнопке

Edit Chart Settings Cheba от схемы. В открывшемся окне Chart Settings отметьте кнопку IL+RL. В поле Fmin [GHz] введите 2.6, в поле Fmax [GHz] введите 3.4. Щёлкните по кнопке Markers и установите маркеры на частотах 3 и 3.1 ГГц. Нажмите Apply и OK.

В области **Design Control** щёлкните по кнопке **Design Options**.

На вкладке **Realization** отметьте **Add input and output lines to the layout**.

На вкладке Technology в поле Substrate Er введите 3.55, в поле Height(H)[mm] введите 0.305, в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.018, в поле Loss Tangent (tanD) введите 0.0027. Нажмите Применить и OK.

Слева от графика нажмите кнопку **REAL**.

Основное окно со схемой в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.46.

Щёлкните по значку View Layout слева от схемы. Синтезированная топология показана на рис.

2.47.

Рис. 2.47

Передайте синтезированную схему в MWO. Для этого щёлкните по кнопке Generate Design. Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта.

В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Analyze design after generation, чтобы анализ выполнялся сразу после передачи в MWO, и Use range below (not project defaults), чтобы для анализа использовать частоты, переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте.

В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 2600 и максимальную 3400 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter.

В области Tuning and Optimization отметьте Mark Tuning Variables, чтобы назначить переменные для настройки. В поле # of steps введите количество точек для анализа 201. Нажмите OK.

Затем нажмите **ОК** в основном окне программы iFilter. В МШО появятся экспортированная схема (рис. 2.48) и график (рис. 2.49).

![](_page_26_Figure_20.jpeg)

![](_page_27_Figure_0.jpeg)

![](_page_27_Figure_1.jpeg)

шаг по оси Х равным 0.1 и по оси У – равным 5. Нажмите Apply и ОК. Удалите переданные из iFilter маркеры. Снова щёлкните по графику правой кнопкой мышки и выберите Add Vertical Line Marker. Установите вертикальную линию маркера на частоту 3 ГГц. Аналогично установите такой же маркер на частоту 3.1 ГГц. График будет выглядеть, как на рис. 2.49. Для удобства чтения маркеров можно изменить шрифт маркеров в свойствах графика. Характеристика фильтра получилась немного сдвинутой

вверх по частоте. Её можно подстроить, используя инструмент настройки MWO. Откройте окно схемы. Обратите внимание, что не все переменные назначены для настройки (рис. 2.50). Щёлкните по значку **Tune Tool** на панели инструментов и назначьте для настройки переменные  $W2_v1$  и  $W2_v2$ . Переменная  $L_v1$  определяет длину входной и выходной линий. Её можно уменьшить, дважды щёлкнув по ней мышкой и изменив значение, например на 3. Переменная  $W_v1$  определяет ширину входного и выходного проводников. Округлит её до значения 0.65. Переменные  $L_v1$  и  $W_v1$  исключите из настройки, щёлкнув по ним инструментом **Tune Tool**, т.к. они практически не влияет на характеристику. Переменная  $L_v3$  определяет длину элемента разомкнутого конца **MOPENX** и ей можно присвоить значение 0. Щёлкните по значку **Tune** на панели инструментов. Подстройте значения параметров элементов схемы, причём сделайте их кратными 0.05 мм, чтобы можно было использовать сетку с таким размером ячеек. Настроенный график может выглядеть, как показано на рис. 2.51.

![](_page_27_Figure_4.jpeg)

• У элементов скачков сопротивления **MSTEPX** параметр смещения **Offset** относительно центральной линии передан из iFilter числовым значением и при настройке он автоматически не изменяется.

![](_page_27_Figure_6.jpeg)

• Между элементами отрезков связанных линий ID=TL3 и ID=TL4, которые имеют разную ширину проводников, а так же между элементами ID=TL5 и ID=TL6 не вставлен элемент скачка сопротивлений.

Это приведёт к тому, что при создании топологии схемы элементы топологии будут соединены неправильно, как, например, показано на рис. 2.52.

Исправить это можно разными способами. Можно создать топологию схемы и затем её отредак-

![](_page_28_Figure_1.jpeg)

тировать. А можно отредактировать сначала саму схему.

Нажмите клавишу Shift и, щёлкая по элементам, отметьте элементы схемы от порта P1 до элементов ID=TL3 и ID=MO4. Нажмите клавишу Ctrl, установите курсор на любой выделенный элемент, нажмите левую кнопку мышки и сдвиньте выделенные элементы влево от схемы, прервав их связь со схемой (рис. 2.53). Скопируйте любой элемент скачка сопро-

тивлений (например, MS1) и подключите его к свободной левой клемме правой части схемы (т.е. к элементу ID=TL4). Выделите все элементы сдвинутой части схемы и подключите их к левой клемме вставленного элемента скачка сопротивлений. Дважды щёлкните по вставленному элементу и введите W1=W2\_v2, W2=W1\_v1.

Аналогично вставьте элемент скачка сопротивлений между элементами связанных линий ID=TL5 и ID=TL6 и для него введите W1=W1\_v1, W2=W2\_v2.

Параметр смещения проводников относительно центральной линии определяется как отрицательная полуразность ширин соединяемых проводников, т.е., например, для первого элемента ID=MS1 и последнего элемента ID=MS4 этот параметр будет равен Offset =  $(W2_v1-W_v1)/2 = (0.45 - 0.65)/2 = -$ 0.1. Для остальных элементов скачка сопротивлений Offset = - 0.05. Заметим, что вместо числовых значений можно для определения Offset в окне свойств элемента писать соответствующее уравнение. Отредактируйте соответственно элементы скачка сопротивлений. Схема будет выглядеть, как показано на рис. 2.54.

![](_page_28_Figure_7.jpeg)

Щёлкните по значку View Layout на панели инструментов. Выберите в меню Edit>Select All и щёлкните по значку Snap Together на панели инструментов, чтобы соединить элементы топологии. Созданная топология схемы показана на рис. рис. 2.55.

![](_page_28_Figure_9.jpeg)

Измерьте длину и ширину топологии, получилось примерно 94.7х7.95.

Щёлкните по значку Add New EM Structure на панели инструментов. Введите имя структуры Fil, отметьте AWR EMSight Simulator и нажмите Create.

Щёлкните по значку Substrate Information. На вкладке Enclosure введите X\_Dim=94.7, Y\_Dim=10, Grid\_X=0.05 и Grid\_Y=0.05. На вкладке Material Defs введите Er=3.55, TanD=0.0027. На вкладке Dielectric Layers введите для слоя 1 толщину 3 и для слоя 2 толщину 0.305. Нажмите OK.

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и скопируйте её в буфер.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте в неё скопированную топологию симметрично относительно корпуса.

Выделите всю топологию и щёлкните по значку Union на панели инструментов, чтобы объединить соприкасающиеся проводники. Щёлкните правой кнопкой мышки по любому выделенному проводнику, выберите Shape Properties, в поле EM Layer введите 2 и определите материал 1/2oz Cu, нажмите OK.

Выделите входной проводник, щёлкните по значку **Edge Port** и установите порт на входе фильтра. Дважды щёлкните по установленному порту и в открывшемся окне установите смещение референсной плоскости 1 мм. Аналогично установите порт и сдвиг референсной плоскости на выходном проводнике. Топология электромагнитной структуры будет выглядеть, как показано на рис. 2.56.

![](_page_29_Figure_1.jpeg)

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры в окне просмотра проекта и выберите **Options**.

На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 2.6 до 3.4 с шагом 0.01, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Loss

Return

![](_page_29_Figure_4.jpeg)

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB(|S(2,1)|) в группе графика в окне просмотра проекта и выберите Properties. В поле Data Source Name введите All Sources, нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter:DB(|S(1,1)|).

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Полученный график электромагнитной структуры показан на рис. 2.57. Полоса пропускания получилась узкой.

Для получения требуемой характеристики уменьшить зазоры между проводниками. Это можно сделать разными способами. Можно вернуться в iFilter и откорректировать исходные данные с учётом полученных результатов. Можно отредактировать топологию

W\_v1=0.65 электромагнитной структуры или топологию схемы. Или можно отредактировать пара-L\_v1=3 метры элементов в схеме.

Откройте окно схемы. Уменьшите величину зазоров, кроме крайних (переменные  $S_v2$  и  $S_v3$ ), на 0.2. Переменные получат значения, как на рис. 2.58.

Откройте окно топологии схемы. Выделите все элементы топологии и щёлкните по значку **Snap Together** на панели инструментов, чтобы соединить все топологические элементы. Скопируйте топологию в буфер обмена.

Откройте окно электромагнитной структуры и удалите топологию из корпуса. Вставьте в корпус скопированную топологию из буфера обмена симметрично корпусу и измените соответственно длину корпуса.

L\_v5=14.65 Назначьте проводникам материал 1/2oz Cu и установите порты со сдвигом рефе-Рис. 2.58 ренсных плоскостей 1 мм.

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке Analyze на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.59. Создайте график WSVR (рис. 2.60).

Полученный график удовлетворяет требованиям по полосе пропускания, но согласование не очень хорошее. Уменьшите крайние зазоры на 0.1 мм.

![](_page_29_Figure_15.jpeg)

Откройте окно электромагнитной структуры и увеличьте масштаб отображения входного проводника и выделите его (рис. 2.61).

L\_v1=3 W2\_v1=0.45 S\_v1=0.15 L\_v2=14.95 L\_v3=0 W2\_v2=0.55 S\_v2=0.55 L\_v4=14.75 W1\_v1=0.65 S\_v3=0.7 L\_v5=14.65

![](_page_30_Figure_0.jpeg)

Установите курсор на выделенный проводник, нажмите левую кнопку мышки и затем нажмите клавишу **Tab**. В открывшемся окошке отметьте **Rel**, введите **dy=-0.05** и нажмите **OK**, чтобы сдвинуть этот проводник вниз. Аналогично сдвиньте выходной проводник вверх, введя **dy=0.05**.

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке Analyze на панели инструментов. Полученные графики показаны на рис. 2.62 и 2.63.

![](_page_30_Figure_3.jpeg)

### 2.2.4. Полосно-пропускающий фильтр со ступенчатыми резонаторами 1.9-2.1 ГГц.

Требования: пятирезонаторный фильтр с полосой пропускания 1.9 – 2.1 ГГц на материале поликор толщиной 1 мм.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandpass и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Stepped Impedance Resonator Filter. В списке Options отметьте Standard. Нажмите OK.

Щёлкните по второй кнопке в области **Type-Approximation** и выберите тип характеристики **Chebyshev**.

В поле **Ripple[dB]** введите величину пульсаций в полосе **0.1**.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

В области Specifications введите 5 в поле degree, 2 в поле F0[GHz], 0.2 в поле BW[GHz], 75 в поле Line Z<sub>0</sub>, 50 в поле RSource.

Щёлкните по верхней кнопке Edit Chart Settings *С* слева от схемы. В открывшемся окне Chart Settings отметьте кнопку IL+RL. В поле Fmin [GHz] введите 1.6, в поле Fmax [GHz] введите 2.6.

Add Opt Goal 🛛 🛛 🛛							
Opt Goal Range							
<ul> <li>Insertion Loss</li> </ul>	Fmin [GHz]	1.9					
OReturn Loss	Fmax [GHz]	2.1					
O Group Delay	Level	3					
O Insertion Phase							
OPhase Variation OGreater than (>)							
OVSWR ●Less than (<)							
OK Cancel							

![](_page_30_Figure_14.jpeg)

Щёлкните по кнопке Markers и установите маркеры на частотах 1.9 и 2.1 ГГц.

Щёлкните по кнопке **Opt Goals** и затем по кнопке Add. Откроется окно для установки цели оптимизации рис. 2.64. Установите цель оптимизации в полосе пропускания. Для этого в поле **Fmin [GHz]** введите **1.9**, в поле **Fmax [GHz]** введите **2.1** и в поле **Level** (Уровень) введите **3**. Отметьте **Less than (<)** и нажмите **OK**. Т.е. целью является получение потерь меньше 3-х дБ в полосе пропускания. Установите цель оптимизации в нижней полосе заграждения. Снова щёлкните по кнопке Add. В поле **Fmin [GHz]** введите **0**, в поле **Fmax [GHz]** введите **1.7** и в поле **Level** введите **40**. Отметьте **Greater than (>)** и нажмите **OK**.Установите цель оптимизации в верхней полосе заграждения. Снова щёлкните по кнопке Add. В поле **Fmin [GHz]** введите **2.3**, в поле **Fmax** 

[GHz] введите 3 и в поле Level введите 40. Отметьте Greater than (>) и нажмите OK.

В окне Chart Settings нажмите Apply и OK.

Цель оптимизации будет отображена на графике в основном окне iFilter.

В области Design Control щёлкните по кнопке Design Options.

На вкладке Realization отметьте Add input and output lines to the layout, Bend/fold long lines when appropriate (Поворачивать/изгибать длинные линии, если возможно) и Alternate input port to save diagonal space, чтобы порты были расположены на одном уровне.

### На вкладке Technology в поле Substrate Er введите 10.2, в поле Height(H)[mm] введите 1, в по-

![](_page_31_Figure_1.jpeg)

![](_page_31_Figure_2.jpeg)

Рис. 2.66

ле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.005, в поле Loss Tangent (tanD) введите 0.001. Нажмите Применить и OK.

Слева от графика нажмите кнопку **REAL**.

Основное окно со схемой в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.65.

Передайте синтезированную схему в МWО. Для этого щёлкните по кнопке Generate Design.

Откроется окно с опциями экспорта (рис. 2.66).

В области General в поле Base Name введите имя для экспортированной схемы, например Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items, если хотите заменить существующую схему с таким же именем.

В области Sche-

matic отметьте Use variables for element parameters, если хотите, чтобы в МWO были созданы переменные для настройки схемы. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto, если хотите, чтобы масштаб по оси Y был фиксированным, а не устанавливался автоматически в зависимости от рассчитанного диапазона единиц измерений. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Analyze design after generation, чтобы в MWO анализ был выполнен сразу после передачи проекта в MWO. Так же отметьте Use range below (not project defaults), чтобы для анализа использовать частоты, переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте.

В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 1200 и максимальную 2800 частоты для анализа.

В области Tuning and Optimization отметьте Mark Tuning Variables, чтобы назначить переменные для настройки. Отметьте Set Optimization Goals, чтобы передать в МШО цели оптимизации. Нажмите OK.

Затем нажмите OK в основном окне программы iFilter.

Рассчитанный в МШО график показан на рис. 2.67. Полоса пропускания синтезированного фильтра меньше требуемой.

Выберите в меню Simulate>Optimize. В открывшемся окне Optimizer можно оставить установи по умолчанию. Щёлкните по кнопке Start. Полученный после оптимизации график показан на рис. 2.68. На граничных частотах после оптимизации ослабление получилось несколько больше требуемого. Мож-

![](_page_32_Figure_0.jpeg)

ширить.

Откройте окно схемы и отредактируйте значения переменных, как показано на рис. 2.70. Переменная  $L_v1$  представляет собой длину входной и выходной линии и её значение не принципиально, например, её можно уменьшить. Переменная  $L_v3$  в схеме не используется, поэтому на неё можно не обращать внимания.

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze**. Рассчитанный график после округления переменных показан на рис. 2.71. Характеристика немного сдвинута вниз и её можно сдвинуть вверх, укоротив длину отрезков связанных линий, т.е. уменьшив значения переменных L\_v2, L\_v5 и L\_v6 на

![](_page_32_Figure_4.jpeg)

0.1 мм (рис. 2.72). Характеристика после такой корректировки будет, как на рис. 2.73. Откройте окно схемы, она будет выглядеть, как на рис. 2.74.

Поскольку мы изменили ширину проводников, нужно откорректировать в элементах скачка сопротивлений MSTEPX параметр сдвига осевых линий Offset для правильного соединения проводников. Причём это нужно сделать только для двух крайних элементов. Для остальных лучше этот параметр оставить равным нулю, чтобы проводники соединялись без сдвига осевых линий.

Для первого элемента скачка сопротивлений Offset = (W2 v1 - W v1)/2 = (0.4 - 1.1)/2 = -0.35. Дважды щёлкните по этому элементу (ID=MS1) и введите Offset = -0.35. Для последнего элемента скачка аналогично введите Offset = 0.35.

Шёлкните по значку View Lavout на панели инструментов, чтобы создать топологию схемы. Выберите в меню Edit>Select All и щёлкните по значку Snap Together на панели инструментов, чтобы соединить элементы топологии. На панели инструментов в окошке значка Grid Spacing оставьте значение по умолчанию 1х, чтобы размер ячеек сетки был равен 0.1 мм. Топология схемы будет, как показано на рис. 2.75.

![](_page_33_Figure_3.jpeg)

Обратите внимание на следующее:

• Входной и выходной проводники расположены не совсем на одном уровне, что обычно не принципиально.

оэтому для электромагнитной структуры луч-	еткой. П	ают с с	впад	и со	логи	гопс	нты	еме	е эл	ев	• H	•	
ше взять сетку с меньшим разме-						• •					· ·	• •	
ром ячеек 0.05 мм, чтобы анализ				•									
выполнялся точнее.						• •							•
Используя элемент измерения	dv : 0.0265			•									
Measure, измерьте длину и ширину топо-	dy:-0		•										•
логии. Эти размеры получились примерно	- · · · · · · ·	· · ·				:	:					• •	
64.273x9.629.						• •							•
Шёлкните по значку Add New EM		· ·								•		• •	
Structure на панели инструментов Ввели-		· · ·	•	•		•							
τε имя структуры Fil отметьте AWR EM-		• •			•								
Sight Simulator и нажмите Create							•	•		•		• •	
Шёлкните по значку Substrate In-					•								
formation На вкладке Enclosure ввелите		• •			•	•	·	÷		•		• •	
X Dim=64.3. V Dim=11.6. Grid X=0.05 µ							÷						
Grid V=0.05 Ha вклалке Material Defs			•	•					• •				•
Situ_i oto: in boughe inuterial beis													

Рис. 2.76

щину 6 и для слоя 2 толщину 1. Нажмите ОК.

Щёлкните по значку Substrate Information. На вкладке Enclosure введите X Dim=64.3, Y Dim=11.6, Grid X=0.05 и Grid Y=0.05. На вкладке Material Defs введите Er=10.2, TanD=0.0001. На вкладке Dielectric Layers введите для слоя 1 тол-

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и скопируйте её в буфер.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте в неё скопированную топологию симметрично относительно корпуса, так чтобы левый край входного проводника точно совпадал с краем корпуса. Выделите в большом масштабе правый край топологии (рис. 2.76). Измерьте расстояние от края проводника до стенки корпуса, в данном случае оно получилось 0.0265 мм.

Дважды щёлкните по выходному проводнику, установите курсор на ромбик посередине правой стороны проводника, нажмите левую кнопку мышки и затем клавишу Таb. В открывшемся окне отметьте Rel, введите dx=0.0265 и нажмите OK. Край проводника должен точно совпасть с краем корпуса.

Выделите всю топологию. Щёлкните правой кнопкой мышки по любому выделенному проводнику, выберите Shape Properties, введите слой EM Layer=2 и определите материал 1/2oz Cu, нажмите OK.

Выделите входной проводник, щёлкните по значку Edge Port и установите порт на входе фильтра. Дважды щёлкните по установленному порту и в открывшемся окне установите смещение референсной плоскости 2 мм. Аналогично установите порт и сдвиг референсной плоскости на выходном проводнике.

![](_page_33_Figure_18.jpeg)

Рис. 2.77

Топология электромагнитной структуры будет выглядеть, как показано на рис. 2.77.

![](_page_34_Figure_1.jpeg)

поэтому нужно увеличить длину резонаторов.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры в окне просмотра проекта и выберите **Options**.

На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 1.2 до 2.8 с шагом 0.01, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB(|S(2,1)|) в группе графика в окне просмотра проекта и выберите Properties. В поле Data Source Name введите All Sources, нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter:DB(|S(1,1)|).

Откройте окно графика и щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Полученный график электромагнитной структуры показан на рис. 2.78. Характеристика получилась сдвинутой вверх по частоте,

![](_page_34_Figure_7.jpeg)

Откройте окно электромагнитной структуры. Увеличьте масштаб отображения первого изгиба и дважды щёлкните по изгибу мышкой. Установите курсор на ромбик нижней стороны нижней полоски изгиба (рис. 2.79), нажмите левую кнопку мышки, затем клавишу **Shift** и сдвиньте эту сторону вниз на 1.1 мм. Не нажимая клавиши **Shift**, сдвиньте вниз на 1.1 мм левую верхнюю точку левого скоса. Аналогично сдвиньте вниз правую верхнюю точку правого сдвига. Затем так же сдвиньте верхнюю сторону нижней полоски изгиба.

Аналогично отредактируйте все изгибы, увеличивая их длину.

Увеличьте ширину корпуса до 13.4 мм и сдвиньте всю топологию симметрично относительно нового корпуса.

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.80. Характеристика получилась более узкой. Чтобы её расширить, нужно уменьшить зазоры в связанных линиях, чтобы увеличить связь.

Откройте окно электромагнитной структуры. Нажмите клавишу Shift и выделите два верхних резонатора, щелкая по их элементам мышкой (рис. 2.81). Установите курсор на любой выделенный про-

![](_page_34_Figure_13.jpeg)

Рис. 2.81

водник, нажмите левую кнопку мышки и затем клавишу **Tab**. В открывшемся окне отметьте **Rel**, введите dy = -0.1 и нажмите **OK**.

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Полученный график вносимого ослабления показан на рис. 2.82, а WSVR – на рис. 2.83.

![](_page_35_Figure_0.jpeg)

Заметим, что описанный способ редактирования топологии не является единственным. Например, можно изменять не только длину изогнутых линий, но и связанных отрезков. При необходимости можно изменять и ширину проводников, и величину зазоров. Такие изменения, возможно, удобнее делать не в электромагнитной структуре, а в схеме, изменяя параметры элементов схемы.

### 2.2.5. Полосно-пропускающий шпилечный фильтр 4 – 4.5 ГГц.

Требования: пятирезонаторный фильтр с полосой пропускания 4 – 4.5 ГГц на материале с диэлектрической проницаемостью 40.5 и толщиной 0.36 мм.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandpass и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Hairpin Bandpass Filter. В списке Options отметьте Standard Open ends. Нажмите OK.

![](_page_35_Figure_6.jpeg)

В поле **Ripple[dB]** введите величину пульсаций в полосе **0.1**.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

В области Specifications введите 5 в поле degree, 4.25 в поле F0[GHz], 0.5 в поле BW[GHz], 30 в поле Reson  $Z_0$ , чтобы ширина проводников в шпильках была не слишком узкой, введите 50 в поле RSource.

Щёлкните по верхней

кнопке Edit Chart Settings слева от схемы. В открывшемся окне Chart Settings отметьте кнопку IL+RL. В поле Fmin [GHz] введите 2.25, в поле Fmax [GHz] введите 6.25. Щёлкните по кнопке Markers и установите маркеры на частотах 4 и 4.5 ГГц. Нажмите Арply и OK.

В области Design Control щёлкните по кнопке Design Options.

На вкладке Technology в поле Substrate Er введите 40,5, в

поле Height(H)[mm] введите 0.36, в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.005, в поле Loss Tangent (tanD) введите 0.001. Нажмите Применить и ОК.

Слева от графика нажмите кнопку REAL.

Основное окно с топологией в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.84.

Передайте синтезированную схему в МWO. Для этого щёлкните по кнопке Generate Design. Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта (рис. 2.85).

Generate D	esian in Microwave Offic	9	X									
⊂ General —		<b>~</b>										
Base Name	Base Name Filter											
└── Overwrite existing items												
CSchematic —												
🗹 Use variab	les for element parameters	Analyze design after generation										
Simplify scher	matic view by hiding	Use range bel	low (not project defaults)									
Name	s	Fmin [MHz]	2250 Set to									
Labels	3	Fmax [MHz	6250 range									
Minor	params	# of stens	201									
🗹 Snapp	ping Grid	* 01 3000-3										
Graphs —		Tuning and Optim	nization									
Use fixed a	axis settings instead of Auto	Mark Tuning	Variables									
Generate		Set Optimizat	tion Goals									
🗹 Insert	ion Loss + Return Loss											
Group	) Delay + Phase ion Loss + SWR											
Insert	ion Loss + Group Delay											
			OK Cancel									

Рис. 2.85

В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Use range below (not project defaults) и Use range below (not project defaults).

В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 2250 и максимальную 6250 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter.

В поле # of steps введите количество точек для анализа 201. Нажмите ОК

Затем нажмите OK в основном окне программы iFilter. В МWO появятся экспортированная схема рис. 2.86 и график рис. 2.87.

![](_page_36_Figure_10.jpeg)

К сожалению, характеристика далека от требуемой.

W1 v1=0.2398

S1 v1=0.4797

S2 v1=0.3256

S4 v1=0.4036

LTOT=3.199

LBot=0.4184

Ltee=0.0052

L\_v1=0.141

W v1=0.05226

L v2=0.01568

Рис. 2.88

Откройте окно схемы и обратите внимание на переданные переменные (рис. 2.88).

W1 v1 – это ширина проводников в шпильках.

S1 v1 – это расстояние между проводниками внутри шпильки. Оно одинаково во всех шпилек. Однако получить оптимальную характеристику часто удаётся получить при различных расстояниях между проводниками внутри шпильки. Поэтому добавьте ещё две переменные для второй и третьей шпилек (следующие шпильки должны быть симметричными относительно первых). Для этого скопируйте эту переменную в буфер. Затем два раза вставьте скопирован-LTop=LTOT-LBot-Ltee ную переменную в схему, изменив их имена на S1 v2 и S1 v3 и назначьте их для настройки. Дважды щёлкните по верхнему элементу связанных линий M10CLIN (ID=TL1) и введите для S3 и S7 значение S1\_v2, для S5 введите значение S1 v3. Аналогичные значения введите для нижнего элемента связанных линий M10CLIN (ID=TL2). Для среднего элемента связанных линий M8CLIN (ID=TL3) для S2 и S6 введите значение S1 v2, для S4 введите значение S1 v3.

В верхней части схемы дважды щёлкните по первому элементу MUBEND (ID=BD2) и введите S=S1 v2. Аналогично отредактируйте соседний элемент MUBEND (ID=BD4). В нижней части схемы дважды щёлкните по среднему элементу MUBEND (ID=BD3) и введите S=S1 v3.

S2 v1 и S4 v1 – это расстояния между шпильками.

LTOT – это длина шпилек. Эта переменная не назначена для настройки. Т.к. при настройке, возможно, потребуется подстраивать характеристику по частоте, назначьте эту переменную для настрой-

ки. W1\_v1=0.25 S1\_v1=0.3 S1\_v2=0.4 S2\_v1=0.15 S1\_v3=0.4 S4\_v1=0.25 LTOT=3.2 LBot=1.2 Ltee=0.25 LTop=LTOT-LBot-Ltee W\_v1=0.05 L\_v1=0.15 L\_v2=0.05 Рис. 2.89

LBot – это расстояние от нижнего конца первой и последней шпилек (от изгиба) до точки подключения входного и выходного проводников.

Ltee – это ширина входного/выходного проводника в точке подключения к фильтру. Эту переменную тоже можно включить в настройку.

LTop - это расстояние от верхнего конца первой и последней шпилек до точки подключения входного и выходного проводников. Т.к. она определяется уравнением, то не может быть включена для настройки.

 $W_v1$ ,  $L_v1$  и  $L_v2$  определяют ширину и длину входного и выходного проводников и конусообразного перехода к точке их подключения к фильтру. Их можно не включать в настройку.

Отредактированные переменные показаны на рис.2.89.

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Tune** на панели инструментов. Настройте параметры элементов схемы, округлив их с точностью до 0.05 мм (рис. 2.90).

![](_page_37_Figure_8.jpeg)

Откройте окно схемы и щёлкните по значку View Layout на панели инструментов, чтобы создать топологию схемы. Выберите в меню Select All и щёлкните по значку Snap Together на панели инст-

![](_page_37_Figure_10.jpeg)

Рис. 2.91

рументов, чтобы соединить элементы топологии. В окошке значка Grid Spacing на панели инструментов введите **0.5**х, чтобы размер ячеек сетки был равен 0.05 мм. Полученная топология схемы показана на рис. 2.91.

Щёлкнув по значку **Measure** на панели инструментов, измерьте длину и ширину топологии. Они получились равными 5.5х3.7 мм.

Щёлкните по значку Add New EM Structure. В открывшемся окне введите имя структуры Fil, отметьте AWR EMSight Simulator и нажмите Create.

Щёлкните по значку Substrate Information на панели инструментов. На вкладке Enclosure открывшегося окна свойств структуры введите X\_Dim=6.5, Y\_Dim=5, Grid X=0.05 и Grid Y=0.05.

### На вкладке Material Defs для слоя Diel 1 ведите Er=40.5, TanD=0.0001.

![](_page_38_Figure_1.jpeg)

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

![](_page_38_Figure_3.jpeg)

На вкладке Dielectric Layers введите толщину для первого слоя 2 и второго слоя 0.36. Нажмите OK.

Откройте окно топологии схемы и скопируйте топологию в буфер обмена.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте скопированную топологию в корпус. Дважды щёлкните по входному проводнику и увеличьте его длину на 0.5 мм. Аналогично увеличьте длину выходного проводника. Поместите топологию симметрично относительно корпуса.

Щёлкните по входному проводнику и установите порт, сместив референсную плоскость на 0.5 мм. Аналогично установите порт на выходном проводнике (рис. 2.92).

Выделите всю топологию, щёлкните правой кнопкой мышки по любому элементу топологии и выберите Shape Properties. Введите слой 2 в EM Layer и введите материал 1/202 Cu.

Щёлкните по имени измеряемой величины Filter: DB(|S(2,1)|) правой кнопкой мышки и выберите Properties. В открывшемся окне в поле Data Source Name введите All Sources и нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter: DB(|S(1,1)|).

Щёлкните правой кнопкой по имени электромагнитной структуры Fil и выберите Options.

В открывшемся окне на вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 2.25 до 6.25 с шагом 0.01, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке **Analyze** на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.93. Он сдвинут вверх по частоте, следовательно, нужно увеличить длину резонаторов.

Откройте окно электромагнитной структуры. Для удобства редактирование объедините отдельные проводники в шпильках. Выделите все резонаторы-шпильки без входного и выходного проводников и щёлкните по значку Union на панели инструментов.

Дважды щёлкните по первой шпильке и увеличьте длину её проводников на 0.15 мм. Щёлкните по второй шпильке и сдвиньте её верх на 0.15 мм. Дважды щёлкните по второй шпильке и увеличьте длину её проводников на 0.15 мм. Аналогично отредактируйте остальные шпильки. Выделите всю топологию и сместите её вниз на 0.1 мм. Структура будет выглядеть, как показано на рис. 2.94.

![](_page_38_Figure_15.jpeg)

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке **Analyze** на панели инструментов. Рассчитанный график показан на рис. 2.95.

### 2.2.6. Полосно-пропускающий встречноштыревой фильтр 11 – 14.5 ГГц.

Требования: шестирезонаторный фильтр с полосой пропускания 11 – 14.5 ГГц на материале R04003C толщиной 0.305 мм, ослабление в диапазоне 17 – 25 ГГц не менее 40 дБ.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandpass и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Interdigital Bandpass Filter. В списке Options отметьте Tapped input/output. Нажмите OK.

Щёлкните по второй кнопке в области Type-Approximation и выберите тип характеристики Chebyshev.

В поле **Ripple**[**dB**] введите величину пульсаций в полосе **0.1**.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

В области Specifications введите 6 в поле degree, 12.75 в поле F0[GHz], 3.5 в поле BW[GHz], 50 в поля Reson  $Z_0$  и RSource.

Щёлкните по верхней кнопке Edit Chart Settings cлева от схемы. В открывшемся окне Chart Settings отметьте кнопку IL+RL. В поле Fmin [GHz] введите 7, в поле Fmax [GHz] введите 25. Щёлкните по кнопке Markers и установите маркеры на частотах 11, 14.4 и 17 ГГц. Нажмите Apply и OK.

В области Design Control щёлкните по кнопке Design Options.

На вкладке Technology в поле Substrate Er введите 3.55, в поле Height(H)[mm] введите 0.305, в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.018, в поле Loss Tangent (tanD) введите 0.0027. На вкладке Parasitics в поле Att [db/cm] введите 0.025. Нажмите Применить и OK.

Слева от графика нажмите кнопку REAL.

Основное окно со схемой в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.96.

![](_page_39_Figure_13.jpeg)

Передайте синтезированную схему в МШО. Для этого щёлкните по кнопке Generate Design. Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта.

В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Analyze design after generation и Use range below (not project defaults), чтобы анализ выполнялся сразу после передачи в МWO и использовались частоты, пере-

![](_page_39_Figure_19.jpeg)

В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 7000 и максимальную 25000 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter.

В области Tuning and Optimization отметьте Mark Tuning Variables, чтобы назначить переменные для настройки. В поле # of steps введите количество точек для анализа 201. Нажмите OK.

Затем нажмите OK в основном окне программы iFilter.

![](_page_40_Figure_1.jpeg)

стройки. Изменяя другие переменные, добейтесь желаемой характеристики (рис. 2.99).

Рис. 2.98

Откройте окно схемы. Переменные, которые не были включены в настройку, почти не влияют на характеристику фильтра. Округлите их значения с точностью до 0.05, например, как показано на рис. 2.100.

Щёлкните по кнопке Analyze и убедитесь, что характеристика почти не изменилась (рис. 2.101).

щёлкните по кнопке Sweep на блоке на-

![](_page_41_Figure_0.jpeg)

![](_page_41_Figure_1.jpeg)

![](_page_41_Figure_2.jpeg)

Щёлкните по значку Substrate Information. На вкладке Enclosure введите X\_Dim=8.95, Y\_Dim=6.3, Grid\_X=0.05 и Grid\_Y=0.05. На вкладке Material Defs введите Er=3.55, TanD=0.0027. На вкладке Dielectric Layers введите для слоя 1 толщину 4 и для слоя 2 толщину 0.305. Нажмите OK.

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и скопируйте её в буфер.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте в неё скопированную топологию симметрично относительно корпуса.

Выделите топологию резонаторов, кроме входных и выходных проводников, и щёлкните по значку Union на панели инструментов, чтобы объединить отдельные элементы в каждом резонаторе. Нажмите клавишу Shift и выделите все проводники, щёлкая по ним мышкой, кроме перемычек. Щёлкните правой кнопкой мышки по любому выделенному проводнику, выберите Shape Properties. Отметьте

Conductor, в EM Layer введите слой 2 и определите материал 1/2oz Cu. Нажмите OK. Снова нажмите клавишу Shift и выделите все перемычки, щёлкая по ним мышкой. Щёлкните правой кнопкой мышки по любой выделенной перемычке, выберите Shape Properties. Отметьте Via, в EM Layer введите слой 2 и определите материал 1/2ог Си. Нажмите ОК. Чтобы убедиться в правильности структуры, можно щёлкнуть по значку View EM 3D Layout на панели инструментов и посмотреть трёхмерное отображение

![](_page_42_Figure_1.jpeg)

Рис. 2.103

структуры.

Выделите входной проводник, щёлкните по значку Edge Port и установите порт на входе фильтра. Дважды щёлкните по установленному порту и в открывшемся окне установите смещение референсной плоскости 1 мм.

Выделите выходной проводник, щёлкните по значку Edge Port и установите порт на выходе фильтра. Дважды щёлкните по установленному порту и в открывшемся окне установите смещение референсной плоскости 1 MM.

Топология электромагнитной структуры будет выглядеть, как показано на рис. 2.103.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры в окне просмотра проекта и выберите Options.

На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 7 до 25 с шагом 0.01, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB([S(2,1)]) в группе графика в окне просмотра проекта и выберите Properties. В поле Data Source Name введите All Sources, нажмите **OK**. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter:DB((S(1,1))).

Откройте окно графика и щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Полученный график электромагнитной структуры показан на рис. 2.104. Характеристика немного сдвинута вверх по частоте и резонаторы нужно немного удлинить.

![](_page_42_Figure_11.jpeg)

Дважды щёлкните по первому резонатору, только не в районе перемычки. Установите курсор на ромбик посредине верхней стороны, нажмите левую кнопку мышки и сдвиньте эту сторону вверх на 0.15 мм. Выделите второй резонатор вместе с перемычкой и сдвиньте его вверх на 0.15 мм. Дважды щёлкните по второму резонатору и сдвиньте его нижнюю сторону вниз на 0.15 мм. Аналогично отредактируйте остальные резонаторы. Но последний резонатор нужно сдвигать вверх вместе с выходными проводниками. Выделите всю топологию и сдвиньте её вниз на 0.1 мм, чтобы она осталась примерно симметричной относительно корпуса.

Откройте окно графика и щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Чтобы не затемнять полученный график, удалите маркеры и взамен установите вертикальные маркеры на частотах 11, 14.5 и 17 ГГц. Полученный график показан на рис. 2.105.

### 2.2.6. Полосно-пропускающий фильтр на параллельных шлейфах 4 – 8 ГГц.

Требования: шестирезонаторный фильтр с полосой пропускания 4 – 8 ГГц на поликоре толщиной 0.5 мм, ослабление на частоте 2 не менее 40 дБ и не менее 20 дБ на частоте 10 ГГц.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandpass и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Shunt Stub Bandpass Filter. В списке Options отметьте 1/4wave lines + 1/4wave stubs (equal). Нажмите OK.

Щёлкните по второй кнопке в области **Type-Approximation** и выберите тип характеристики **Chebyshev**.

В поле Ripple[dB] введите величину пульсаций в полосе 0.1.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

В области Specifications введите 6 в поле degree, 6 в поле F0[GHz], 4 в поле BW[GHz], 50 в поля i Filter - BPF - Shunt Stub Bandpass Filter Reson Z<sub>0</sub> и RSource.

Щёлкните по верхней кнопке Edit

**Chart Settings** слева от схемы. В открывшемся окне **Chart Settings** отметьте кнопку **IL+RL**. В поле **Fmin [GHz]** введите **2**, в поле **Fmax [GHz]** введите **10**. Щёлкните по кнопке **Markers** и установите маркеры на частотах **4** и **8** ГГц. Нажмите **Аррly** и **OK**.

В области **Design Control** щёлкните по кнопке **Design Options**.

На вкладке Technology в поле Substrate Er введите 10.35, в поле Height(H)[mm] введите 0.5, в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.005, в поле Loss Tangent (tanD) введите 0.001. Нажмите Применить и OK.

На вкладке **Parasitics** введите **0.02** в поле Att [db/cm].

Слева от графика нажмите кнопку **REAL**.

Основное окно с топологией в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.106.

Передайте синтезированную схему в МWO. Для этого щёлкните по кнопке

Generate Design. Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта. В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite exist-

ing items.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Analyze design after generation и Use range below (not project defaults), чтобы анализ выполнялся сразу после передачи в МШО и использовались частоты, переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте. В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 2000 и максимальную 10000 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter.

![](_page_43_Figure_21.jpeg)

![](_page_43_Figure_23.jpeg)

Рис. 2.106

В области Tuning and Optimization отметьте Marc Tuning Variables, чтобы переданные в МWO переменные были включены в настройку. Нажмите ОК. Нажмите **ОК** в основном окне iFilter.

![](_page_44_Figure_1.jpeg)

VV v1=0.45

=4 v1=0.6

v1=0.25√ v3=0.5

v2=0.25

V3=0.6

\_v3=0.25

Рис. 2.110

v7=0.3 v5=4.85

\_v6=0.8

v5=0.35

D\_v2=0.6

L\_v1=2.4 W\_v2=0.8

H\_v1=0.5

D

Переданная в MWO схема показана на рис. 2.107, а рассчитанный график на рис. 2.108. Характеристика сдвинута вниз по частоте.

> Откройте окно схемы. Переданные переменные показаны на рис. 2.109. Обратите внимание на следующее. Ширине проводника второго элемента отрезка линии ID=TL3 присвоена переменная W=W v3, а ширине проводника предпоследнего элемента отрезка линии ID=TL11 присвоена переменная W=W\_v9. Но элементы фильтра должны быть симметричными. Поэтому дважды щёлкните по предпоследнему элементу отрезка линии ID=TL11 и присвойте W=W\_v3 вместо W=W v9. Аналогичная ситуация и со следующими элементами отрезка линии ID=TL5 и **ID=TL9**. Дважды щёлкните по элементу отрезка линии ID=TL9 и присвойте W=W v5 вместо W=W\_v8. Переменные W=W\_v8 и W=W\_v9 удалите из списка переменных.

> Округлите все переменные с точностью до 0.05 мм

.Переменные W v1 и L v1 являются длиной и шириной входной и выходной линий. Исключите их из настройки (рис. 2.110).

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке Analyze на панели инструментов.

Щёлкните по значку **Типе** на панели инструментов, чтобы открыть блок настройки. На блоке настройки для всех переменных назначьте шаг изменения 0.05. Перемещая движки на блоке настройки, настройте параметры элементов схемы для получения нужной характеристики (рис. 2.111).

Откройте окно схемы. Щёлкните по кнопке View Layout на панели инструментов, чтобы создать топологию схемы. Выделите всю топологию и щёлкните по значку Snap Together на панели инструментов, чтобы правильно соединить элементы топологии. В окошке значка Grid Spacing на панели инструментов введите 0.5х. Топология схемы показана на рис. 2.112.

v8=0.367 W v9=0.5232 Рис. 2. 109

W\_v1=0.4602

L\_v1=2.395 W\_v2=0.796

v2=4.265

T\_v1=0.2388 W\_v3=0.5234

L\_v3=4.762 VV\_v4=0.7958

D v2=0.5968

v4=4.835

D v3=0.5968

v5=4.868

T\_v3=0.2387

v5=0.3671

\_v6=0.7957

v7=0.3064

T\_v2=0.2387

Ŵ.

D\_v1=0.597

H\_v1=0.5

Измерьте длину и ширину топологии, получилось 32.85х5.1 мм.

Щёлкните по значку Add New EM Structure на панели инструментов. Введите имя структуры Fil, отметьте AWR EMSight Simulator и нажмите Create.

Щёлкните по значку Substrate Information. На вкладке Enclosure введите X Dim=32.85, Y Dim=7.1, Grid X=0.05 и Grid Y=0.05. На вкладке Material Defs введите Er=10.35, TanD=0.001. На вкладке Dielectric Layers введите для слоя 1 толщину 6 и для слоя 2 толщину 0.5. Нажмите ОК.

![](_page_44_Figure_13.jpeg)

Return Loss

![](_page_45_Figure_0.jpeg)

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и скопируйте её в буфер.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте в неё скопированную топологию симметрично относительно корпуса.

Выделите всю топологию и щёлкните по значку Union на панели инструментов, чтобы объединить отдельные элементы топологии.

Выделите всю топологию проводников, щёлкнув по ней мышкой в любом месте, кроме перемычек. Щёлкните правой кнопкой мышки по выделенным проводникам и выберите Shape Properties. Отметьте Conductor, в EM Layer введите слой 2 и определите материал 1/2oz Cu, нажмите OK. Нажмите клавишу Shift и выделите все перемычки, щёлкая по ним мышкой. Щёлкните правой кнопкой мышки по любой выделенной перемычке, выберите Shape Properties. Отметьте Via, в EM Layer введите слой 2 и определите материал 1/2oz Cu, нажмите OK. Чтобы убедиться в правильности структуры, можно щёлкнуть по значку View EM 3D Layout на панели инструментов и посмотреть трёхмерное отображение структуры.

Выделите топологию проводников, щёлкните по значку **Edge Port** и установите порт на входе фильтра. Дважды щёлкните по установленному порту и в открывшемся окне установите смещение референсной плоскости 1 мм. Аналогично установите порт и сдвиг референсной плоскости на выходе фильтра.

Топология электромагнитной структуры будет выглядеть, как показано на рис. 2.113.

![](_page_45_Figure_7.jpeg)

Рис. 2.113

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры в окне просмотра проекта и выберите Options. На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 2 до 10 с шагом 0.01, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB([S(2,1)]) в группе графика в окне просмотра проекта и выберите Properties. В поле Data Source Name введите All Sources, нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter:DB([S(1,1)]).

![](_page_45_Figure_11.jpeg)

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Полученный график электромагнитной структуры показан на рис. 2.114. Характеристика немного сдвинута вверх по частоте и резонаторы нужно немного удлинить.

Откройте окно электромагнитной структуры.

Дважды щёлкните по топологии проводников. Установите курсор на ромбик посредине нижней стороны первого резонатора, нажмите левую кнопку мышки и сдвиньте её на 0.2 мм вниз. Аналогично удлините все остальные резонаторы на такую же величину.

Установите курсор левее и выше первой перемычки, но не выше топологии, нажмите левую кнопку мышки и переместите курсор по диагонали правее и ниже последней перемычки, чтобы выделить все перемычки. Установите курсор на любую выделенную перемычку, нажмите левую кнопку мышеи и сместите перемычки вниз на 0.2 мм.

Откройте окно графика и щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Результаты анализа на рис. 2.115.

### 2.2.7. Полосно-заграждающий фильтр на параллельных шлейфах.

Требования: девятиэлементный заграждающий фильтр на частоту заграждения 6 ГГц и частотами отсечки 4 и 8 ГГц на поликоре толщиной 0.5 мм.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandstop и Microstrip.

В списке Main Filter type отметьте Optimum Distributed Bandstop Filter. В списке Options отметьте 16.4 dB Return Loss. Нажмите OK.

Щёлкните по второй кнопке в области **Туре-Approximation** и выберите тип характеристики Chebyshev.

В области Specifications введите 9 в поле degree, 6 в поле F0[GHz], 4 в поле BW[GHz], 50 в поля Reson Z<sub>0</sub> и RSource.

![](_page_46_Figure_9.jpeg)

Chart Settings отметьте кнопку IL+RL. В поле Fmin [GHz] введите 2, в поле Fmax [GHz] введите 10. Щёлкните по кнопке Markers и установите маркеры на частотах 4 и 8 ГГц. Нажмите Apply и OK.

В области Design Control щёлкните по кнопке Design **Options**.

На вкладке Realization отметьте Add input and output lines to the layout, Split Shunt impedances if smaller than Zmin и в поле ввода ведите 30.

На вкладке **Technology** в поле Substrate Er введите 10.35, в поле Height(H)[mm] введите 0.5. в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.005, в поле Loss Tangent (tanD) введите 0.001. Нажмите Применить и ОК.

Слева от графика нажмите кнопку **REAL**.

Основное окно с топологией в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.116.

Передайте синтезированную схему в МWO. Для этого

щёлкните по кнопке Generate Design. Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта.

В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Analyze design after generation и Use range below (not project defaults), чтобы анализ выполнялся сразу после передачи в МШО и использовались частоты, переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте.

В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 2000 и максимальную 10000 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter. Нажмите OK.

![](_page_47_Figure_1.jpeg)

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и скопируйте её в буфер.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте в неё скопированную топологию симметрично относительно корпуса.

Выделите всю топологию и щёлкните по значку Union на панели инструментов, чтобы объединить отдельные элементы топологии.

![](_page_48_Figure_0.jpeg)

Выделите всю топологию проводников, щёлкнув по ней мышкой в любом месте. Щёлкните правой кнопкой мышки по выделенным проводникам и выберите Shape Properties. Отметьте Conductor, в EM Layer введите слой 2 и определите материал 1/2oz Cu. Щёлкая по значку

Edge Port, установите порты на входе и выходе фильтра. Установите смещение референсных плоскостей 1 мм.

![](_page_48_Figure_3.jpeg)

Топология электромагнитной структуры будет выглядеть, как показано на рис. 2.123.

Щёлкните правой кнопкой по имени электромагнитной структуры Fil и выберите Options.

В открывшемся окне на вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 2000 до 10000 с шагом 40, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB(|S(2,1)|) в группе графика в окне просмотра проекта и выберите Properties. В поле Data Source Name введите All Sources, нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter:DB(|S(1,1)|).

Откройте окно графика и щёлкните по кнопке **Analyze** на панели инструментов. Полученный график показан на рис. 2.124.

### 2.2.8. Полосно-пропускающий фильтр с боковыми связями 14 – 18 ГГц.

Требования: пятирезонаторный фильтр с полосой пропускания 14 – 18 ГГц на поликоре толщиной 0. 5 мм. Ослабление на частотах 12 и 22 ГГц не менее 10 дБ.

Откройте iFilter. Щёлкните по кнопке типов фильтра. В открывшемся окне Select Filter Type щёлкните по кнопкам Bandpass и Microstrip.

Т.к. полоса пропускания широкая, крайние зазоры будут узкие, поэтому выберем фильтр с кондуктивной связью. В списке Main Filter type отметьте Edge Coupled Bandpass Filter. В списке Options отметьте Tapped input/output. Нажмите OK.

![](_page_48_Figure_13.jpeg)

В поле **Ripple[dB]** введите величину пульсаций в полосе **0.1**.

Щёлкните по кнопке Environment Options, на вкладке Units открывшегося окна отметьте единицы измерения mm и GHz, нажмите Применить и OK.

В области Specifications введите 5 в поле degree, 16 в поле F0[GHz], 4 в поле BW[GHz], 50 в поля Reson  $Z_0$  и RSource.

Щёлкните по верхней кнопке

Edit Chart Settings Cheea от схемы. В открывшемся окне Chart Settings отметьте кнопку IL+RL. В поле Fmin [GHz] введите 10, в поле Fmax [GHz] введите 22. Щёлкните по кнопке Markers и установите маркеры на частотах 12, 14, 18 и 20 ГГц. Нажмите Apply и OK.

В области **Design Control** щёлкните по кнопке **Design Options**.

На вкладке **Realization** отметьте **Add input and output lines to the layout**.

На вкладке Technology в поле Substrate Er введите 10.65, в поле Height(H)[mm] введите 0.5, в поле Cond. Thickness(t)[mm] (толщина проводника) введите 0.005, в поле Loss Tangent

Рис. 2.125

### (tanD) введите 0.001. Нажмите Применить и ОК.

Слева от графика нажмите кнопку REAL.

Основное окно со схемой в области отображения результатов будет выглядеть, как показано на рис. 2.125.

Передайте синтезированную схему в MWO. Для этого щёлкните по кнопке Generate Design. Откроется окно Generate Design in Microwave Office с опциями экспорта.

В области General в поле Base Name введите Filter. В этой же области отметьте Overwrite existing items.

В области Schematic отметьте Use variables for element parameters. В списке ниже этой опции отметьте элементы схемы, которые желательно скрыть для упрощения отображения схемы.

В области Graphs отметьте Use fixed axis settings instead of Auto. В этой же области отметьте тип графика Insertion Loss + Return Loss.

В области Analysis отметьте Analyze design after generation, чтобы график был рассчитан сразу после передачи проекта в MWO, и Use range below (not project defaults), чтобы для анализа использовать частоты, переданные из iFilter, а не частоты, установленные в проекте.

В этой же области в поля Fmin [MHz] и Fmax [MHz] введите минимальную 10000 и максимальную 22000 частоты для анализа. Или щёлкните по кнопке Set to current range, чтобы установить текущие частоты в iFilter.

В области Tuning and Optimization отметьте Mark Tuning Variables, чтобы назначить переменные для настройки. В поле # of steps введите количество точек для анализа 201. Нажмите OK.

![](_page_49_Figure_10.jpeg)

Затем нажмите **OK** в основном окне программы iFilter. В MWO появятся экспортированная схема (рис. 2.126) и рассчитанный график (рис. 2.127).

![](_page_49_Figure_12.jpeg)

Откройте окно схемы. Обратите внимание на переданные переменные (рис. 2.128). Переменные  $W_v1$  и  $L_v1$  присвоены входному и выходному проводникам, и они могут быть исключены из настройки. Переменная  $L_v5$  является длиной элементов разомкнутых концов линии **MOPENX**, которые относятся к скрытым параметрам (Show Secondary). Поэтому ей можно присвоить просто значение **0**.

Переменные W2\_v1 и W2\_v2 присваиваются ширине проводников связанных линий и эти переменные лучше включить в настройку.

Округлите переменные с точностью до 0.025 мм. Переменные будут выглядеть, как показано на рис. 2.129.

Откройте окно графика. Щёлкните по значку **Tune** на панели инструментов и настройте элементы схемы до получения требуемой характеристики (рис. 2.130).

Откройте окно схемы. При настройке схемы мы изменили ширину проводников, поэтому необходимо отредактировать параметр Offset в элементах скачка сопротивлений MSTEPX. Значение этого параметра определяется как отрицательная полуразность ширин присоединенных к этому элементу проводников (см. пример 2.2.3). Дважды щёлкните по первому элементу MSTEPX (ID=MS1). В открывшемся окне свойств элемента введите Offset=-0.075. Такое же значение Offset=-0.075 введите для последнего элемента MSTEPX (ID=MS4). Для второго элемента MSTEPX (ID=MS2) и третьего MSTEPX (ID=MS3) введите Offset=-0.0625.

![](_page_50_Figure_0.jpeg)

Т.к. мы решили использовать сетку с ячейками 0.025, то желательно иметь возможность получить такую сетку в окне топологии схемы. Выберите в меню Options>Layout Options. В открывшемся окне на вкладке Layout в поле Grid spacing введите 0.05 и нажмите OK.

![](_page_50_Figure_2.jpeg)

Рис. 2.132

![](_page_50_Figure_4.jpeg)

![](_page_50_Figure_5.jpeg)

панели инструментов. Установите курсор мышки на левый нижний угол вертикального проводника, нажмите левую кнопку мышки и двигайте курсор по диагонали влево и вниз, чтобы создать прямоугольник размером 2x0.45 (рис. 2.133). Щёлкните по значку Polygon на панели инструментов. Установите курсор мышки на правый нижний угол созданного прямоугольника, щёлкните левой кнопкой мышки и двигайте курсор вверх к правому

верхнему углу созданного прямоугольника, щёлкните мышкой, двигайте курсор вправо к правому нижнему углу вертикального проводника и дважды щёлкните мышкой (рис. 2.133).

> Аналогично отредактируйте выходную часть фильтра. Должна получиться топология, показанная на рис. 2.134.

> > Измерьте длину и ширину топологии, получилось примерно 12.7x2.875.

> > Щёлкните по значку Add New EM Structure на панели инст-

рументов. Введите имя структуры Fil, отметьте AWR EMSight Simulator и нажмите Create.

Щёлкните по значку View Lavout на панели инструментов. Выберите в меню Edit>Select All и щёлкните по значку Snap Together на панели инструментов, чтобы соединить элементы топологии. В окошке значка Grid spacing на панели инструментов введите 0.5х. Созданная топология схемы показана на рис. рис. 2.131.

Увеличьте масштаб входной части фильтра так, чтобы была видна сетка. Пользуясь полосами скроллинга, убедитесь, что все элементы топологии совпадают с сеткой.

Выделите в большом масштабе выходную часть фильтра и переместите выходной проводник на верхнюю часть резонатора, чтобы ширина всей топологии была меньше (рис. 2.132).

Выделите в большом масштабе входную часть фильтра. Щёлкните по значку Rectangle на

![](_page_50_Figure_16.jpeg)

Щёлкните по значку Substrate Information. На вкладке Enclosure введите X\_Dim=12.7, Y\_Dim=5, Grid\_X=0.025 и Grid\_Y=0.025. На вкладке Material Defs введите Er=10.65, TanD=0.001. На вкладке Dielectric Layers введите для слоя 1 толщину 6 и для слоя 2 толщину 0. 5. Нажмите OK.

Откройте окно топологии схемы, выделите всю топологию и скопируйте её в буфер.

Откройте окно электромагнитной структуры и вставьте в неё скопированную топологию симметрично относительно корпуса.

Выделите всю топологию. Щёлкните правой кнопкой мышки по любому выделенному проводнику, выберите Shape Properties, в поле EM Layer введите 2 и определите материал 1/2oz Cu, нажмите OK. Щёлкните по значку Union на панели инструментов, чтобы объединить соприкасающиеся проводники.

![](_page_51_Figure_4.jpeg)

Рис. 2.135

Filter IL RL 0 0 -5 -2.5 -10 -5 -7.5 -15 -20 -10 -25 -12.5 nsertion Loss -30 -15 -35 -17.5 -40 -20 -45 -22.5 + DB((S(2,1))) (L) -50 -25 -27.5 -55 ▲ DB(|S(2,1)|) (L) -60 -30 <mark>⊁</mark> DB(|S(1,1)|) (R) -32.5 -65 -70 -35 -75 -37.5 Filte -80 -40 18 12 -13 14 15 16 17 19 20 21 22 10 11 Frequency (GHz) Рис. 2.136

Выделите входной проводник, щёлкните по значку Edge Port и установите порт на входе фильтра. Дважды щёлкните по установленному порту и в открывшемся окне установите смещение референсной плоскости 1 мм. Аналогично установите порт и сдвиг референсной плоскости на выходном проводнике.

Топология электромагнитной структуры будет выглядеть, как показано на рис. 2.135.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени электромагнитной структуры в окне просмотра проекта и выберите **Op**tions.

На вкладке Frequencies снимите отметку в Use project defaults и введите диапазон частот от 10 до 22 с шагом 0.1, нажмите Apply. На вкладке EMSight отметьте Enable AFS и нажмите OK.

Щёлкните правой кнопкой мышки по имени измеряемой величины Filter:DB([S(2,1)]) в группе графика в окне просмотра проекта и выберите Properties. В поле Data Source Name введите All Sources, нажмите OK. Аналогично отредактируйте измеряемую величину Filter:DB([S(1,1)]).

Откройте окно графика и щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов.

Чтобы не затемнять рассчитанный

график, удалите маркеры и установите вертикальные маркеры на частотах 12, 14, 18 и 20 ГГц. График будет выглядеть, как показано на рис. 2.136. Полоса пропускания получилась уже требуемой и с большими пульсациями.

Loss

Return

![](_page_51_Figure_14.jpeg)

Откройте окно электромагнитной структуры. Выделите два первых резонатора с входным проводником и сместите их вниз на 0.05 мм, чтобы уменьшить второй зазор. Затем выделите первый резонатор с входным проводником и сместите его вниз на 0.05 мм, чтобы уменьшить первый зазор. Аналогично уменьшите предпоследний и последний зазоры, смещая соответствующие резонаторы вверх на 0.05 мм. Затем нужно подбором изменить размеры кондуктивной связи, чтобы улучшить согласование. После чего нужно укоротить длину резонаторов, чтобы сдвинуть характеристику вверх по частоте и соответственно уменьшить длину корпуса. Отредактируйте эти размеры так, как показано на рис. 2.137. Характеристика потерь будет иметь вид, показанный на рис. 2.138, а VSWR – на рис. 2.139.

![](_page_52_Figure_1.jpeg)